



メンテナンスおよびサービス ガイド

一部日本では販売していないオプション品がございます。

概要

このガイドでは、交換部品、部品の取り外しと取り付け、セキュリティ、バックアップなどについて説明します。

AMDおよびRadeonは、米国Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Bluetoothは、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいてHP Inc. が使用しています。Bluetoothは、その所有者が所有する商標であり、ライセンスに基づいてHP Inc.が使用しています。Intel、Core、Thunderbolt、Optane、およびXeonは、米国Intel Corporationおよびその関連会社の米国およびその他の国における商標です。MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。NVIDIAおよびQuadroは、NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

USB Type-CおよびUSB-Cは、USB Implementers Forumの登録商標です。DisplayPortおよびDisplayPortロゴは、米国Video Electronics Standards Association (VESA) が所有する米国およびその他の国における商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスの保証は、すべて該当する製品およびサービスに付属の明示の保証書に記載されています。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2020年8月

製品番号：M07792-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのワークステーションでは使用できない場合があります。

Windowsのエディションまたはバージョンによっては、一部の機能を使用できない場合があります。システムでWindowsの機能を最大限に活用するには、アップグレードされたハードウェアや別売のハードウェア、ドライバやソフトウェア、またはBIOSの更新が必要になる場合があります。Windows 10は自動的に更新され、自動更新は常に有効になっています。更新中にプロバイダー料金がかかったり追加要件が適用されたりすることがあります。詳しくは、<https://www.microsoft.com/ja-jp/> を参照してください。

最新版のユーザー ガイドを確認するには、HPのサポートWebサイト、<http://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。次に、[ユーザーガイド]を選択します。

ソフトウェア条項


このワークステーションにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様はHP使用許諾契約（EULA）の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を14日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはワークステーションの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

Windowsのエディションによっては、一部の機能を使用できない場合があります。このワークステーションでWindowsの機能を最大限に活用するには、アップグレードされたハードウェア、ドライバ、またはソフトウェアや、別売のハードウェア、ドライバ、またはソフトウェアが必要になる場合があります。詳しくは、<https://www.microsoft.com/ja-jp/> を参照してください。

安全に関するご注意

以下に説明されている使用方法を守ることによって、低温やけどやワークステーションが過熱状態になる可能性を減らすことができます。

 **警告！** 低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にワークステーションを置いて使用したり、肌に直接ワークステーションが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、ワークステーションが過熱状態になるおそれがありますので、ワークステーションの通気孔をふさいだりしないでください。ワークステーションが過熱状態になると、やけどやワークステーションの損傷の原因になる可能性があります。ワークステーションは、硬く水平な場所に設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、外部電源アダプターの動作中に長時間外部電源アダプターを皮膚、または枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものに接触させないでください。お使いのワークステーションおよび外部電源アダプターは、この製品に適用される安全規格で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。

目次

1	ワークステーションの機能	1
	前面の各部	1
	背面の各部	2
	左側面の各部	3
	製品仕様	3
2	図による部品カタログ	4
	ワークステーションの主なコンポーネント	4
	大容量ストレージ デバイス	6
	その他の部品	8
3	日常のお手入れ、SATAドライブのガイドライン、取り外し準備	9
	静電気放電に関する情報	9
	発生する静電気量	9
	静電気による機器への損傷の防止	10
	身体のアース（接地）方法と装置	10
	作業エリアのアース（接地）	11
	推奨する材料および装置	11
	操作のガイドライン	12
	日常的なお手入れ	12
	一般的な清掃に関する安全上の注意事項	12
	ワークステーション表面の清掃	12
	キーボードの清掃	13
	モニターの清掃	13
	マウスの清掃	13
	保守上の留意事項	14
	工具とソフトウェアの要件	14
	ネジ	14
	ケーブルおよびコネクタ	14
	ハードディスク ドライブ	14
	ボタン型リチウム電池	15
	SATAハードディスク ドライブ	15
	ケーブルの管理	16
4	取り外しおよび取り付け手順	17
	部品取り外しの準備	17

上面カバー	18
内部部品の位置の確認	18
メモリ モジュール (SODIMM)	19
ソリッドステート ドライブ	22
ハードディスク ドライブ	23
グラフィックス ファン、ヒート シンク、およびカード	24
スピーカー	25
ファン	26
温度センサー	27
背面のポート拡張ボード	27
プロセッサ ヒート シンク	28
プロセッサ	30
電源ボタン ボード	31
システム ボード	32
底面カバー	34
電池	34
無線 LAN モジュール	35
無線アンテナおよびケーブル	37
5 コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ ([HP Computer Setup])	38
[HP Computer Setup] の使用	38
[HP Computer Setup] : [Main] (メイン)	39
[HP Computer Setup] : [Security] (セキュリティ)	41
[HP Computer Setup] : [Advanced] (詳細設定)	44
6 POST エラー メッセージ	50
POST 時の数値コードおよびテキスト メッセージ	50
システム検証用のフロント パネルのランプおよびビープ音の診断	55
7 パスワードのセキュリティおよび CMOS の再設定	58
セットアップ パスワードまたは電源投入時パスワードの変更	58
セットアップ パスワードまたは電源投入時パスワードの削除	59
8 [HP PC Hardware Diagnostics] の使用	60
Windows 版の [HP PC Hardware Diagnostics] の使用 (一部の製品のみ)	60
Windows 版の [HP PC Hardware Diagnostics] のハードウェア障害 ID コードの使用	60
Windows 版の [HP PC Hardware Diagnostics] へのアクセス	60
[スタート] メニューからの Windows 版の [HP PC Hardware Diagnostics] へのアクセス	60
[HP Support Assistant] からの Windows 版の [HP PC Hardware Diagnostics] へのアクセス	60

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード.....	61
HPからの最新バージョンのWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード.....	61
[Microsoft Store]からのWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード ..	61
製品名または製品番号を使用したWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード（一部の製品のみ） ..	61
Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のインストール.....	62
UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]の使用	62
UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のハードウェア障害IDコードの使用	62
UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]の起動	62
UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のUSBフラッシュ ドライブへのダウンロード.....	63
最新バージョンのUEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード.....	63
製品名または製品番号を使用したUEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード（一部の製品のみ）	63
[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定の使用（一部の製品のみ）	63
[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード.....	64
最新バージョンの[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード	64
製品名または製品番号による[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード.....	64
[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定のカスタマイズ.....	64
9 バックアップ、復元、および回復	65
情報のバックアップおよびリカバリ メディアの作成	65
Windowsツールを使用したバックアップ	65
[HP Cloud Recovery Download Tool]を使用したリカバリ メディアの作成（一部の製品のみ） ..	65
システムの復元およびリカバリ	65
システムの復元の作成	66
復元およびリカバリの方法	66
[HP Recovery]メディアを使用した復元	66
ワークステーションのブート順序の変更	66
[HP Sure Recover]の使用（一部の製品のみ）	67
10 メモリ揮発性について	68
現在のBIOSステップ	68
不揮発性メモリの使用状況	70
Q&A.....	72
[HP Sure Start]の使用（一部の製品のみ）	73
11 電源コードセットの要件	74
一般的な要件	74
日本の電源コードの要件	74


各国および各地域固有の要件	74
12 仕様	76
索引	77

1 ワークステーションの機能

この章では、ワークステーションの機能の概要について説明します。

前面の各部

以下の図と表で、フロント パネルの各部の位置と名称を確認してください。

 **注：**お使いのモデルのワークステーションの外観は、このセクションの図と若干異なる場合があります。

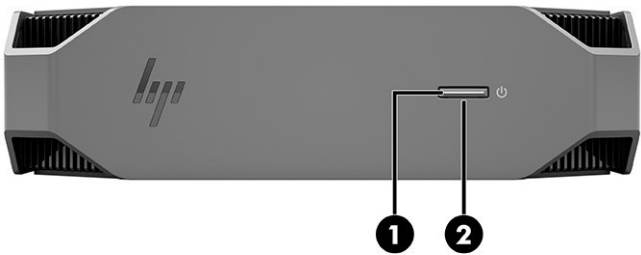



表1-1 前面の各部とその説明

項目	アイコン	名称
1		電源ボタン
2		電源ランプ

背面の各部

以下の図と表で、リア パネルの各部の位置と名称を確認してください。

 **注：**お使いのモデルのワークステーションの外観は、このセクションの図と若干異なる場合があります。

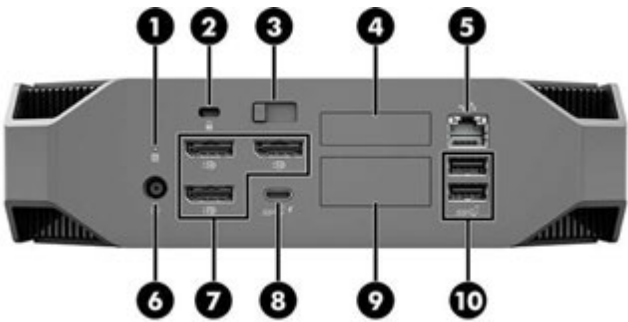









表1-2 背面の各部とその説明

項目	アイコン	名称	項目	アイコン	名称
1		HDD動作ランプ	6		電源コネクタ
2		セキュリティ ロック ケーブル用スロット	7		DisplayPort™ (DP) (×3)
3		アクセス パネルのリリース ラッチ	8		USB Type-C® SuperSpeed Plusポート (HPスリープおよび充電機能付き) (オプション)
4		シリアルコネクタ (オプション)	9		HP Flex IOモジュール (オプション) 以下のものをサポートします <ul style="list-style-type: none">●VGAコネクタ●HDMI出力端子●DisplayPort™●2つ目のネットワーク コネクタ●USB-C 3.1 Gen2充電用データ ポート●デュアルUSB Type-A 3●Thunderbolt™ 3.0ポート
5		RJ-45 (ネットワーク) コネクタ	10		USB SuperSpeedPlusポート (×2)


注：リア パネルのコネクタのラベルには、業界標準のアイコンおよび色が使用されています。

注：DPコネクタは、システムにインテル® Xeon® E3-12x0 v5プロセッサが搭載されている場合にはサポートされていません。他のすべてのプロセッサでは、ディスクリート グラフィックスカードが取り付けられている場合、これらのDPコネクタは初期設定で無効になっています。

注：3台以上のモニターを使用したい場合、[HP Computer Setup]で、内蔵インテルHDグラフィックス カードとディスクリートグラフィックス カードを同時に使用できるように設定できます。ただし、モニターを3台以上接続する場合は、ディスクリートグラフィックス カードのみを使用することをおすすめします。

左側面の各部

以下の図と表で、左側パネルの各部の位置と名称を確認してください。

 **注：**お使いのモデルのワークステーションの外観は、このセクションの図と若干異なる場合があります。

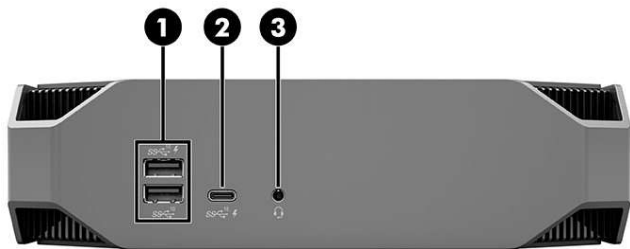





表1-3 左側面の各部とその説明

項目	アイコン	名称
1		USB SuperSpeedPlusポート（HPスリープおよび充電機能付き）（×2）
2		USB Type-C SuperSpeedPlusポート（HPスリープおよび充電機能付き）
3		オーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク）コンボ コネクタ

製品仕様

このセクションでは、お使いのワークステーションに関する技術仕様の確認方法について説明します。


お使いの製品の『QuickSpecs』を確認するには、<http://www.hp.com/go/quickspecs/>（英語サイト）にアクセスして、[Search all QuickSpecs]（すべての『QuickSpecs』を検索）を選択します。[Search]（検索）ボックスにお使いのモデル名を入力して、[Go]（移動）を選択します。

または

HPのサポートWebサイト、<http://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。[製品情報]を選択してから、お使いのワークステーションの仕様を選択します。

2 図による部品カタログ

ワークステーションで利用可能な交換部品を確認するには、以下に示す情報を参照してください。

 **注：**HPでは、継続的に製品の部品を改善および変更しています。お使いのワークステーションでサポートされている部品の最新情報を確認するには、<http://partsurfer.hp.com/>（英語サイト）にアクセスし、国または地域を選択してから、画面の説明に沿って操作します。

ワークステーションの主なコンポーネント

以下の図と表で、ワークステーションの主なコンポーネントの位置と名称を確認してください。

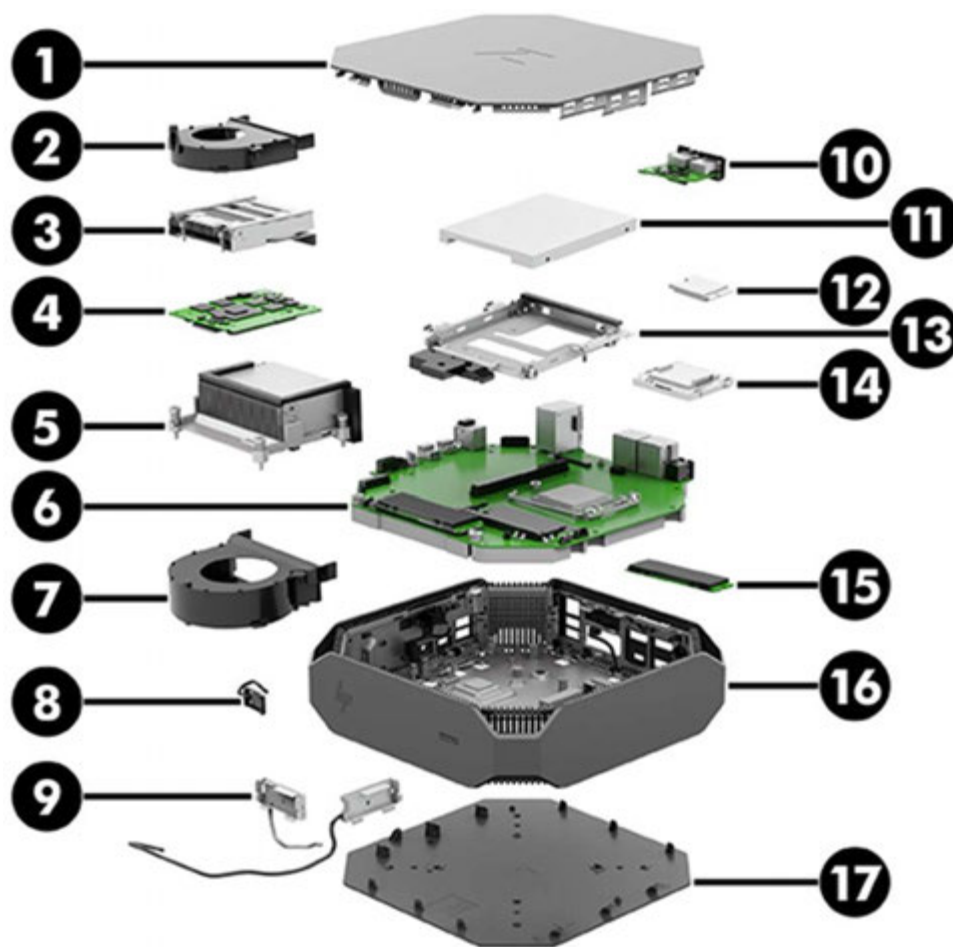


表2-1 ワークステーションの主なコンポーネントとその説明

項目	説明
(1)	上面カバー
(2)	システム ファン

表2-1 ワークステーションの主なコンポーネントとその説明（続き）

項目	説明
(3)	グラフィックス ヒート シンク
	125 W、AMD®
	125 W、NVIDIA®
	65 W/80 W、AMD
	65 W/80 W、NVIDIA
(4)	グラフィックスカード
	NVIDIA Quadro® T2000
	NVIDIA Quadro T1000
	NVIDIA Quadro P620
	AMD Radeon® Pro WX 3200
(5)	ヒートシンク
(6)	システム ボード（交換用の放熱材料を含む）
	パフォーマンス
	エントリ
(7)	グラフィックス ファン
	125 W/65 W、28 mm
	125 W/65 W、18 mm
(8)	スピーカー
(9)	無線アンテナ
(10)	背面のポート拡張ボード
	ネットワーク インターフェイス コントローラー（NIC）
	Thunderbolt 3
	デュアルUSB 3.1 Type-A
	USB/NIC
	デュアルUSB 3.1 Type-A/シリアル
	USB Type-C®
	HDMI
	DisplayPort
	シリアル
	VGA
(11)	ハードディスク ドライブ
	1 TB、7200 rpm
	500 GB、7200 rpm
	500 GB、7200 rpm、自己暗号化ドライブ（SED）、Opal2
	256 GB、SATA-3、ソリッドステート ドライブ
(12)	無線LANモジュール
(13)	コネクタ付きハードディスク ドライブ ケージ

表2-1 ワークステーションの主なコンポーネントとその説明（続き）

項目	説明
(14)	プロセッサ（交換用の放熱材料を含む）
	インテル® Core™ i7-10900（2.8 GHz、20 MB Intel Smart Cache、10コア、65 W）
	インテルCore i7-10900K（3.7 GHz、20 MB Intel Smart Cache、10コア、125 W）
	インテルCore i7-10700（2.9 GHz、16 MB Intel Smart Cache、8コア、65 W）
	インテルCore i7-10700K（3.8 GHz、16 MB Intel Smart Cache、8コア、125 W）
	インテルCore i5-10600（3.3 GHz、12 MB Intel Smart Cache、6コア、65 W）
	インテルCore i5-10600K（4.1 GHz、12 MB Intel Smart Cache、6コア、125 W）
	インテルCore i5-10500（3.1 GHz、12 MB Intel Smart Cache、6コア、65 W）
	インテルCore i5-10400（2.9 GHz、12 MB Intel Smart Cache、6コア、65 W）
	インテルCore i3-10320（3.8 GHz、8 MB Intel Smart Cache、4コア、65 W）
	インテルCore i3-10300（3.7 GHz、8 MB Intel Smart Cache、4コア、65 W）
	インテルCore i3-10100（3.6 GHz、6 MB Intel Smart Cache、4コア、65 W）
	インテルXeon® W-1290P（3.7 GHz、20 MB Intel Smart Cache、10コア、125 W）
	インテルXeon W-1290（3.2 GHz、20 MB Intel Smart Cache、10コア、80 W）
	インテルXeon W-1270P（3.8 GHz、16 MB Intel Smart Cache、8コア、125 W）
	インテルXeon W-1270（3.4 GHz、16 MB Intel Smart Cache、8コア、80 W）
	インテルXeon W-1250P（4.1 GHz、12 MB Intel Smart Cache、8コア、125 W）
	インテルXeon W-1250（3.3 GHz、12 MB Intel Smart Cache、6コア、80 W）
	2 TB、TLC
	1 TB、TLC
	512 GB、TLC
	512 GB、TLC、自己暗号化ドライブ（SED）
	256 GB、TLC
	256 GB、TLC、自己暗号化ドライブ（SED）
(15)	ソリッドステートドライブ（M.2 2280、PCIe）
(16)	システム シャーシ
	周辺（温度）センサー（図には示されていません）
(17)	底面カバー
	電源ボタン ボードおよびハードディスク ドライブランプケーブルキット（図には示されていません）
	メモリ モジュール（PC4-3200、図には示されていません）
	32 GB
	16 GB
	8 GB
	4 GB
	メモリ モジュール（PC4-3200、ECC）
	16 GB
	8 GB
	4 GB

大容量ストレージデバイス

以下の表で、使用可能なハードディスク ドライブおよびソリッドステート ドライブを確認してください。

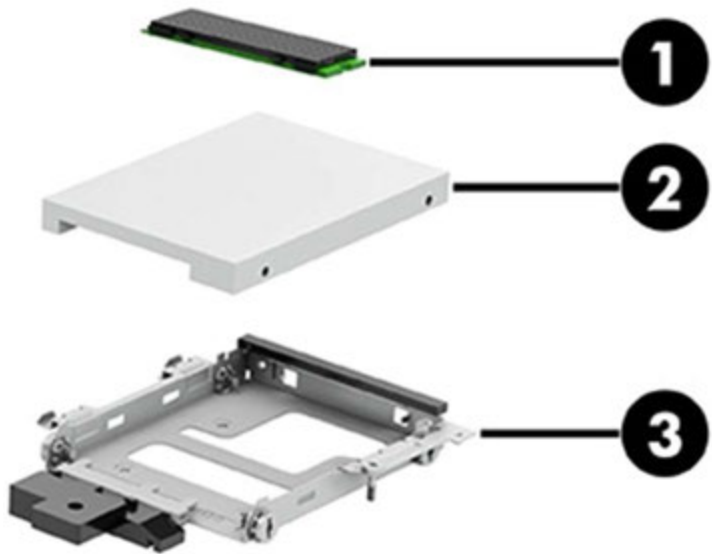


表2-2 大容量ストレージデバイスとその説明

項目	説明
(1)	ソリッドステート ドライブ (M.2 2280、PCIe)
	2 TB、TLC
	1 TB、TLC
	512 GB、TLC
	512 GB、TLC、自己暗号化ドライブ (SED)
	512 GB + 32 GB Optane™ メモリ
	256 GB、TLC
	256 GB、TLC、自己暗号化ドライブ (SED)
	256 GB + 16 GB Optane メモリ
	128 GB、TLC
	16 GB Optane メモリ モジュール
(2)	ハードディスク ドライブ
	2 TB、5400 rpm
	1 TB、7200 rpm
	500 GB、7200 rpm
	500 GB、7200 rpm、自己暗号化ドライブ (SED)、Opal2
	500 GB、7200 rpm、FIPS
(3)	ハードディスク ドライブ ケージ

その他の部品


以下の表で、ワークステーションの各種部品を確認してください。

表2-3 その他の部品とその説明

説明
SATAデータおよび電源コード（ハードディスク ドライブで使用）
アダプター
USB-C - DisplayPort
USB-C - HDMI 2.0
USB-C - VGA
DisplayPort - HDMI 2.0
DisplayPort - DVI
HPワイヤレスプレミアム マウス
HP USBプレミアム マウス
キーボード
ワイヤレス キーボードおよびマウス
USB、スリム、スマートカード
ワイヤレス プレミアム キーボード
USBプレミアム キーボード
電源コード（C5）
外部電源アダプター（7.4 mm、PFC）
280 W
180 W

3 日常のお手入れ、SATAドライブのガイドライン、取り外し準備

ここでは、ワークステーションの一般的なサービス情報について説明します。保守サービスを正しく行うためには、以下の手順と予防措置に従うことが基本的に重要です。

 **重要：**ワークステーションが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていてもシステムボードには常に電気が流れています。感電やシステムの損傷を防ぐため、ワークステーションのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

静電気放電に関する情報

人間の指など、導電体からの突然の静電気放電によって、静電気に弱いデバイスやマイクロ回路が破壊される可能性があります。火花が感知されたり聞こえたりしなくても、損傷が生じることはよくあります。

電子デバイスが静電気放電（ESD）にさらされても、何らかの影響を受けているように見えるとは限らず、通常のサイクルで完全に動作することもあり得ます。デバイスはしばらくの間は正常に機能する場合がありますが、内層で劣化して寿命が短くなっています。

多くの集積回路に組み込まれたネットワークは一定の保護を提供しますが、放電には多くの場合、デバイス パラメーターを変更したり、シリコンの接続部を溶融させたりするための十分な電力が含まれています。

重要：内部部品の取り外しや取り付けの作業を行うときは、デバイスの損傷を防ぐため、以下のことを守ってください。

- 取り付ける準備が整うまでは、部品を静電気防止措置が施された専用のケースに入れたままにしておきます。
- 電子部品に触れる前に、このセクションで説明されているガイドラインに従って静電気を放電するようにします。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品の取り扱いをできるだけ少なくします。部品を取り外した場合は、静電気防止措置が施されたケースに入れます。

発生する静電気量

以下の表は、さまざまな作業者の行動によって生成される静電電圧レベルに湿度がどのように影響するかを示しています。製品は700ボルトで劣化する可能性があります。

- 発生する静電気量は、作業者の行動によって異なります。
- また、静電気は湿度が低いほど増加します。

表3-1 行動と湿度に基づいて発生する静電気量

イベント	相対湿度		
	55%	40%	10%
カーペットの上の歩行	7,500 V	15,000 V	35,000 V
ビニールの床の上の歩行	3,000 V	5,000 V	12,000 V
ベンチ作業者の動作	400 V	800 V	6,000 V

表3-1 行動と湿度に基づいて発生する静電気量（続き）

	相対湿度		
	400 V	700 V	2,000 V
プラスチック チューブからDIP（デュアル インラインパッケージ）を取り出す			
ビニールトレイからDIPを取り出す	2,000 V	4,000 V	11,500 V
発泡スチロールからDIPを取り出す	3,500 V	5,000 V	14,500 V
PCB（プリント基板）からバブルパックを取り出す	7,000 V	20,000 V	26,500 V
発泡プラスチック内張りの箱にPCBを詰める	5,000 V	11,000 V	21,000 V
複数の電気部品をプラスチック チューブ、トレイ、または発泡スチロールにまとめて梱包できます。			

静電気による機器への損傷の防止

多くの電子部品は、ESD（静電気放電）対策が必要です。回路設計と構造によって、影響を受ける度合いが異なります。静電気による電子部品の損傷を防ぐには、以下の梱包とアース（接地）の予防措置を取る必要があります。

- 手が製品に触れないように、チューブ、袋、箱などの静電防止コンテナに製品を入れて運搬します。
- 静電気対策が必要なすべての部品およびアセンブリは、導電性または専用のケースや梱包箱に入れて保護します。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置が施されている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごとアースされている場所に置きます。
- 静電気に弱い部品に触れるときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行います。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。
- アセンブリの静電気対策が必要な部品で再利用できるものは、保護パッケージまたは導電性フォームの中に置きます。

身体のアース（接地）方法と装置

静電気による電子部品の損傷を防ぐために、以下の装置を使用してください。

- **アースバンド**は柔軟な帯状のもので、アースコード内の抵抗は最大 $1\text{ M}\Omega \pm 10\%$ です。適切にアースするには、素肌にぴったりと着くようにストラップを巻き付ける必要があります。アースコードは、アースマットまたは作業場所のバナナプラグコネクタに接続し、ぴったりと収まっている必要があります。
- **ヒールストラップ/トーストラップ/ブーツストラップ**は立ったまま作業をする場合に使用します。たいいていの場合、どのような靴にも対応します。導電性の床または静電気拡散フロアマット上で、オペレーターとアース間の抵抗が最大 $1\text{ M}\Omega \pm 10\%$ のストラップを両足に付けます。

表3-2 静的シールド保護レベル

静電シールドの保護レベル	
方法	電圧
静電防止プラスチック	1,500
カーボン入りプラスチック	7,500
メタライズラミネート	15,000

作業エリアのアース（接地）

作業エリアでの静電気による損傷を防止するため、以下のことを守ってください。

- 作業台の上を静電気拡散性材で覆います。作業台の上に接続したアース バンドと、適切にアースされた工具および機器を準備します。
- 静電気拡散性材のマット、フット ストラップ、またはエアー イオナイザーを使ってさらに保護を確実にします。
- 静電気に弱いコンポーネント、部品、およびアセンブリは、ケースまたはPCBラミネートに入れて取り扱います。必ず、静電気の発生しない作業エリアで作業します。
- コネクタやテスト装置の挿入および取り外しを行う前に、電源および入力信号をオフにします。
- 治工具を拡散性の表面に直接接触させざるを得ない場合は、静電防止型のものを使用します。
- 作業エリアには、アセンブリの周りに使われている通常のプラスチックや発泡スチロールなどの非導電性材料を置かないようにします。
- カッター、ドライバー、掃除機などの現場での作業用ツールは、導電性のものを使用します。

推奨する材料および装置

静電気を防ぐため、以下の材料および機器を使用することをおすすめします。

- 静電防止テープ
- 静電防止スモック、エプロン、またはスリーブ プロテクター
- 導電性の箱、アセンブリ、はんだ付け用補助材
- 導電性フォーム
- 抵抗が $1\text{ M}\Omega \pm 10\%$ のアース（接地）コード付きの導電性の表面の作業台
- 確実にアースされた静電気拡散性のテーブルまたはフロア マット
- 現場での作業用キット
- 静電気注意ラベル
- 抵抗が $1\text{ M}\Omega \pm 10\%$ のアースバンドおよび靴用ストラップ
- 材料取り扱いパッケージ
- 導電性のビニール袋
- 導電性のプラスチック パイプ
- 導電性の部品・工具箱
- 不透明シールド袋
- 透明メタライズ シールド袋
- 透明シールド チューブ

操作のガイドライン

ここでは、過熱を防止し、ワークステーションの寿命を延ばす方法について詳しく説明します。

- 湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所、または極端に温度が高い場所や低い場所には置かないでください。
- ワークステーションは、安定した平らな場所に設置してください。また、通気が確保されるよう、ワークステーションの通気孔のある面およびモニターの上部に、少なくとも10 cmの空間を確保してください。
- 内部への通気が悪くなりますので、絶対にワークステーションの通気孔をふさがないでください。キーボードを横置き構成の本体のフロントパネルに立てかけることも、おやめください。
- ワークステーションの通気孔やモニター上部の通気孔は、ときどき掃除してください。糸くずやほこりなどの異物によって通気孔がふさがれると、内部への通気が悪くなり、故障の原因となります。通気孔を清掃する前に、必ずワークステーションの電源プラグを抜いてください。
- ワークステーションのカバーやサイドパネルを取り外したまま使用しないでください。
- ワークステーションを積み重ねたり、互いの排気や熱にさらされるほどワークステーションどうしを近くに置いたりしないでください。
- ワークステーションを別のエンクロージャに入れて操作する場合、吸気孔および排気孔がエンクロージャに装備されている必要があります。また、この場合にも前に示したガイドラインを守ってください。
- ワークステーション本体やキーボードに液体をこぼさないでください。
- モニター上部の通気孔は、絶対にふさがないでください。
- スリープ状態を含む、オペレーティング システムやその他のソフトウェアの電源管理機能をインストールするか有効にしてください。

日常的なお手入れ

ワークステーションのお手入れを正しく行うには、以下の情報を参照してください。

一般的な清掃に関する安全上の注意事項

ワークステーションを安全に清掃するには、以下の情報を参照してください。

1. ワークステーションは、溶剤や可燃性の溶液で拭かないでください。
2. 部品を水やクリーニング溶液に浸さないでください。清潔な布に液体をしみ込ませて、部品を拭いてください。
3. 液体や軽く湿らせた布で清掃するときは、必ずワークステーションの電源プラグを抜いてください。
4. 必ずワークステーションの電源プラグを抜いてから、キーボード、マウス、または通気孔を清掃してください。
5. キーボードを清掃する場合には、ケーブルを外してください。
6. キーボードを清掃する場合には、側面に覆いのある安全眼鏡を着用してください。

ワークステーション表面の清掃

ワークステーションの表面を清掃する前に、安全上の注意事項すべてに従ってください。ワークステーションの表面を清掃するには、以下の手順に沿って操作します。

- 少しの染みや汚れは、汚れのない柔らかい布または綿棒を水で湿らせて取り除いてください。
- 強い汚れには、水で薄めた低刺激の食器用洗剤を使用します。きれいな水で湿らせた布または綿棒で拭いて、洗剤をしっかりと拭き取ります。

- しつこい汚れには、イソプロピル（消毒用）アルコールを使用します。アルコールはすぐに揮発し跡が残らないため、拭き取る必要はありません。イソプロピルアルコールは保管および使用上の注意を守ってお使いください。
- 清掃が終了したら、汚れのない柔らかい布で必ずユニットを拭いてください。
- ワークステーションの通気孔をときどき清掃してください。糸くずや異物によって通気孔がふさがれて、通気が妨げられていることがあります。

キーボードの清掃


キーボードを正しく清掃するには、以下の情報を参照してください。キーボードを清掃する前に、安全上の注意事項すべてに従ってください。

キーの上面またはキーボード本体を清掃するには、[12ページの「ワークステーション表面の清掃」](#)で説明されている手順に従います。

キーの下のごみを清掃する場合は、以下の手順に従う前に、[12ページの「一般的な清掃に関する安全上の注意事項」](#)のすべてのルールを確認してください。

 **注意：**キーの下のごみを清掃する場合は、側面に覆いのある安全眼鏡を着用してください。

- キーの下や間にある目に見えるごみは、掃除機を使用するか振り落として除去できます。
- キーの下のごみは、エアークリーナーを使用して除去できます。空気圧が強過ぎると、横長のキーの潤滑油が吹き飛ばされることがありますので、注意してください。
- キーを取り外す場合は、キーを破損しないように専用のキー引き抜き工具を使用してください。この工具は、一般的な電気部品販売店で購入できます。

 **重要：**横長の平らなキー（スペース バーなど）は、キーボードから取り外さないでください。これらのキーを取り外したり取り付けたりすると、キーボードが正しく動作しなくなることがあります。

- キーの下は、イソプロピル アルコールで湿らせて余分なアルコールを絞り出した綿棒で清掃できます。イソプロピルアルコールは保管および使用上の注意を守ってお使いください。適切なキー動作に必要な潤滑油を拭き取らないよう注意してください。狭い場所にある繊維やごみはピンセットで取り除いてください。部品は、取り付けなおす前に空気乾燥させます。

モニターの清掃

モニターを正しく清掃するには、以下の情報を参照してください。

- 水で湿らせた清潔な布またはモニター清掃用のウェットティッシュでモニター画面を拭きます。画面に直接スプレーやエアゾールを吹きかけないでください。液体が筐体の隙間から内部にしみ込んで、コンポーネントが損傷することがあります。溶剤や可燃性の液体をモニターに使用しないでください。
- モニター本体を清掃するには、[12ページの「ワークステーション表面の清掃」](#)の手順で操作します。

マウスの清掃

マウスを正しく清掃するには、以下の情報を参照してください。

マウスを清掃する前に、ワークステーションの電源がオフになっていることを確認してください。

- マウスのボールを清掃するには、最初に保持プレートとボールを筐体から取り外します。ボールソケットからごみを取り出し、清潔で乾いた布でボールを拭いてから、取り付けなおします。
- マウス本体を清掃するには、[12ページの「ワークステーション表面の清掃」](#)の手順に従います。

保守上の留意事項

ワークステーションの分解および組み立て時は、以下のことに留意してください。

工具とソフトウェアの要件


ワークステーションの保守には、以下の工具が必要です。

- T-15トルクスドライバー
- マイナスドライバー（トルクスドライバーの代わりに使用場合があります）
- P1プラスドライバー
- 非導電性の傷の付かないこじ開けツール
- 診断ソフトウェア

ネジ

ワークステーションで使用されているネジは交換できません。ネジ山には標準のものとメートル式のものがあり、ネジの長さもさまざまです。


再組み立て中に誤ったネジを使用すると、ユニットが損傷するおそれがあります。分解中に取り外したすべてのネジは、後で正しい位置に戻せるよう、取り外した部品と一緒に保管しておくことを強くおすすめします。

 **重要：**ワークステーションから取り外した個々の小さい部品は、損傷を防ぐために、作業エリアから離れた場所に置いてください。

ケーブルおよびコネクタ

ケーブルを正しく取り扱うには、以下の情報を参照してください。

ケーブルを挿入したり、取り外したりするときに無理な力を加えないでください。可能であれば常に、ケーブルはコネクタを持って取り扱ってください。どのような場合でも、ケーブルを曲げたりねじったりしないでください。また、ケーブルの配線は、取り外す部品や取り付けの部品にひっかかったり、ぶつかったりすることがないように行ってください。

 **重要：**このワークステーションを保守するにあたり、再組み立て作業中は必ずケーブルを正しい位置に配置するようにしてください。ケーブルの配置が不適切な場合、ワークステーションが損傷するおそれがあります。

ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブは壊れやすい精密部品として取り扱い、物理的な衝撃や振動を避けてください。この情報は交換用スペアだけでなく故障したドライブにも当てはまります。


- ドライブを送付するときは、気泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。
- ハードディスクドライブを保管するとき、出荷時のパッケージから取り出さないでください。ハードディスクドライブは、実際にワークステーションに取り付けるまでは、保護パッケージに入れて保管します。
- どのような高さからも、またどのような表面にもドライブを落下させないでください。
- ハードディスクドライブを挿入または取り外す場合は、ワークステーションの電源を切ります。ワークステーションの電源が入っている場合またはスタンバイモードになっている場合は、絶対にハードディスクドライブを取り外さないでください。


- ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つときは、コネクタに手を触れないようにしてください。
- ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニターやスピーカーなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。

ボタン型リチウム電池

ワークステーションには、リアルタイム クロックに電源を供給する電池が付属しており、寿命はおよそ3年です。

交換手順については、作業対象のシャーシに対応した取り外しおよび取り付けの項目を参照してください。

 **警告！** このワークステーションにはリチウム電池が含まれています。電池を正しく取り扱わないと、火災や化学やけどのおそれがあります。電池を分解する、つぶす、穴をあける、ショートさせる、水中や火中に投じる、60℃（140°F）を超える場所に放置するなどの行為はおやめください。電池を充電しないでください。

 **注：** 電池、電池パック、蓄電池は、一般家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。リサイクル施設での処分や適切な廃棄のために、公共の回収システムを利用するか、HP、認定パートナー、または代理店に返却してください。

SATAハードディスク ドライブ

HPワークステーション用の自己監視分析および記録テクノロジー（SMART）ATAドライブには、ハードディスク ドライブの差し迫った障害やクラッシュをユーザーまたはネットワーク管理者に警告するドライブ障害予測が組み込まれています。

SMARTドライブは、再割り当てセクター数、スピン再試行回数、キャリブレーション再試行回数などの故障予測および障害兆候パラメーターを追跡します。障害が差し迫っているとドライブが判断した場合、故障アラートが生成されます。

表3-3 SATAハードディスク ドライブの特性

シリアルATAハードディスク ドライブの特性	
データ ケーブルのピン数/導体数	7/7
電源ケーブルのピン数	15
データ ケーブルの最大長	100 cm（39.4インチ）
データ インターフェイス電圧差	400 ~ 700 mV
ドライブ電圧	3.3 V、5 V、12 V
ドライブを構成するためのジャンパー	なし
データ転送速度	6.0 Gbps

SATA 1.5 Gbpsドライブとの完全な下位互換性があるため、必ずHP認定のSATA 6.0 Gbpsケーブルを使用してください。現在のHPワークステーション製品には、SATA 6.0 Gbpsハードディスク ドライブが付属しています。

SATAデータ ケーブルは、過度に曲げると損傷を受けやすくなります。SATAデータ ケーブルは折りたたまないでください。また、曲げたときの半径が30 mm未満にならないようにしてください。

SATAデータ ケーブルは、1台のドライブのためだけにデータを送信するように設計された細い7ピンケーブルです。


ケーブルの管理


ワークステーションの内部で作業するときは、必ず適切にケーブルを管理してください。

- ヒート シンクのような熱源部からケーブルを離してください。
- 部品が移動したときに、ケーブルが切断されたり妨害されたりしないように、スライド部や可動部にはケーブルを配置しないでください。
- 平らなりボン ケーブルを折りたたむときは、きつく折り曲げないでください。きつく折り曲げると、ワイヤが破損するおそれがあります。
- ケーブルを強く曲げないでください。きつく折り曲げると内部のワイヤが断線するおそれがあります。
- SATAデータ ケーブルは、曲げたときの半径が30 mm未満にならないようにしてください。
- SATAデータ ケーブルは折りたたまないでください。

4 取り外しおよび取り付け手順

保守サービスを正しく行うためには、以下の手順と予防措置に従うことが基本的に重要です。必要な取り外しおよび取り付け手順をすべて完了した後、診断ユーティリティを実行して、すべてのコンポーネントが正しく動作することを確認してください。

 **注：**このガイドに記載するすべての機能を、すべてのワークステーションで使用できるとは限りません。


 **注：**HPでは、継続的に製品の部品を改善および変更しています。お使いのワークステーションでサポートされている部品の最新情報を確認するには、<http://partsurfer.hp.com/>（英語サイト）にアクセスし、国または地域を選択してから、画面の説明に沿って操作します。

部品取り外しの準備

ワークステーションの分解および再組み立てを正しく行うには、以下の情報を参照してください。


安全のための初期手順については、[9ページの「日常のお手入れ、SATAドライブのガイドライン、取り外し準備」](#)を参照してください。


1. ワークステーションの電源を切ります。ワークステーションの電源がオフになっているか、休止状態になっているかわからない場合は、ワークステーションの電源を入れた後、オペレーティングシステムをシャットダウンします。

 **重要：**ケーブルを取り外す前に、ワークステーションの電源を切ってください。

システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。システムによっては、ワークステーションがスタンバイ モードやサスペンド モードの場合にも、冷却ファンはオンになっています。装置の保守サービスを行う前に、必ず電源コードを抜いてください。

2. ワークステーションから電源コードを抜いて、ワークステーションの電源を切断します。
3. ワークステーションからすべての外付けデバイスを取り外します
4. ワークステーションがスタンドの上に置かれている場合は、ワークステーションをスタンドから取り外します。

 **注意：**シャーシ内の鋭いエッジに注意してください。

 **注：**分解作業中は、取り外した各ケーブルにラベルを付け、その位置と配線をメモしてください。ネジはすべて、取り外したコンポーネントと一緒に保管してください。

上面カバー

上面カバーを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。上面カバーを取り外す前に、以下の操作を行います。

- ▲ 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。

以下の手順で上面カバーを取り外します。

- ▲ リリースラッチをスライドさせてから（1）、上面カバーを持ち上げてワークステーションから取り外します（2）。



上面カバーを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

内部部品の位置の確認

基本的な内部部品の位置と名称を確認するには、このセクションを参照してください。

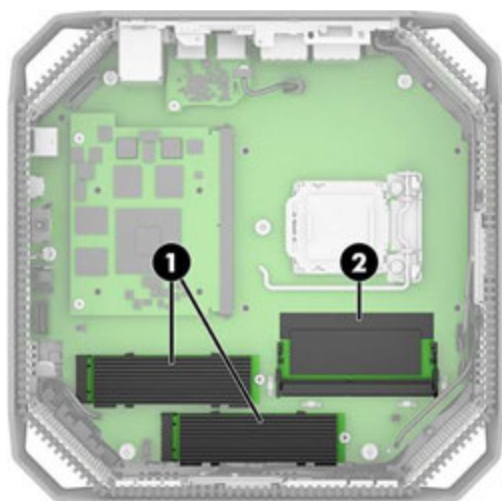


表4-1 上部の内部部品

名称	
(1)	ソリッドステートドライブ
(2)	メモリ モジュール（セカンダリ）

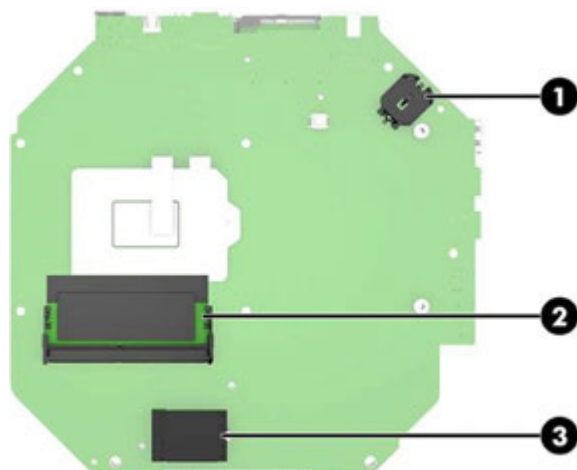


表4-2 下部の内部部品

名称	
(1)	RTC用電池
(2)	メモリ モジュール (プライマリ)
(3)	無線LANモジュール

メモリ モジュール (SODIMM)

ワークステーションにはメモリ モジュールが2つあり、1つはシステム ボードの上部に、もう1つはシステム ボードの下部にあります。メモリ モジュールを取り外すには、このセクションの情報および手順に沿って操作します。

システム ボード上のメモリ ソケットには、業界標準SODIMMを2つまで装着できます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも1つのSODIMMが標準装備されています。最大容量のメモリ構成にするために、最大64 GBのメモリをシステム ボードに搭載できます。

表4-3 メモリ モジュールの仕様


コンポーネント	仕様
メモリ モジュール	1.2ボルトDDR4-SDRAMメモリ モジュール
準拠	アンバッファード非ECC DDR4-3200 MHz準拠 アンバッファードECC DDR4-3200 MHz準拠
ピン	業界標準の260ピン (必須のJoint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) 仕様を含む)
スロット	2
最大メモリ	64 GB
サポートされているもの	2ギガビット、4ギガビット、8ギガビット、および16ギガビットの非ECCメモリ テクノロジー 片面および両面メモリ モジュール

注：サポートされていないメモリ モジュールを取り付けると、システムが正しく動作しません。×8および×16 DDRデバイスで構成されたメモリ モジュールはサポートされています。×4 SDRAMで構成されたメモリ モジュールはサポートされていません。

SODIMMソケットに正しく装着するには、以下の情報を参照してください。

システム ボード上にはSODIMMソケットが2つあり、チャンネルごとに1つのソケットがあります。これらのソケットには、DIMM1およびDIMM3というラベルが付けられています。DIMM1ソケットはメモリチャンネルBで動作し、DIMM3ソケットはメモリチャンネルAで動作します。

ワークステーションには、ダブルデータレート3シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ（DDR4-SDRAM）スモールアウトラインデュアルインラインメモリモジュール（SODIMM）が付属しています。

 **重要：**メモリモジュールの取り付けまたは取り外しを行う前に、電源コードを抜いて電力が放電されるまで約30秒待機する必要があります。ワークステーションが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、メモリモジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリモジュールの着脱を行うと、メモリモジュールまたはシステムボードに回復不能な損傷を与えるおそれがあります。

重要：メモリモジュールを取り扱うときは、接点に触れないよう注意してください。接点に触れると、モジュールを損傷するおそれがあります。

メモリモジュールソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリをアップグレードするときは、接点の金属が異なるときに生じる腐食や酸化を防ぐために、金メッキされた金属接点を備えたメモリモジュールを使用してください。

静電気の放電によって、ワークステーションや別売のカードの電子部品が破損することがあります。作業を始める前に、アース（接地）された金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

表4-4 メモリモジュールのソケットの位置

位置	説明	システムボード上の表記
システムボードの上部	SODIMM1ソケット、チャンネルB	DIMM1
システムボードの下部	SODIMM3ソケット、チャンネルA	DIMM3

SODIMMの取り付け方法に応じて、システムはシングルチャンネルモード、デュアルチャンネルモード、またはフレックスモードで自動的に動作します。

- 1つのチャンネルのSODIMMソケットにのみ装着されている場合、システムはシングルチャンネルモードで動作します。
- チャンネルAのSODIMMのメモリ容量がチャンネルBのSODIMMのメモリ容量と等しい場合、システムはより高性能なデュアルチャンネルモードで動作します。
- チャンネルAのSODIMMのメモリ容量がチャンネルBのSODIMMのメモリ容量と異なる場合、システムはフレックスモードで動作します。フレックスモードでは、容量の最も少ないメモリが装着されているチャンネルがデュアルチャンネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残りはシングルチャンネルに割り当てられます。一方のチャンネルのメモリ容量が他方のチャンネルのメモリ容量よりも多い場合は、多い方をチャンネルAに割り当てます。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅いSODIMMによって決定されます。

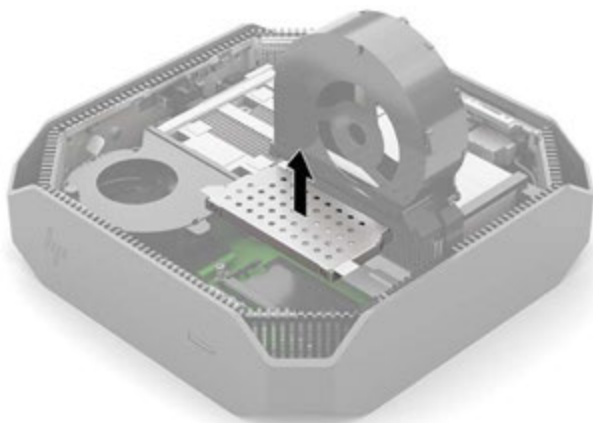
メモリモジュールを交換する前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)）。
3. メモリモジュールの位置を確認します（[18ページの「内部部品の位置の確認」](#)）。

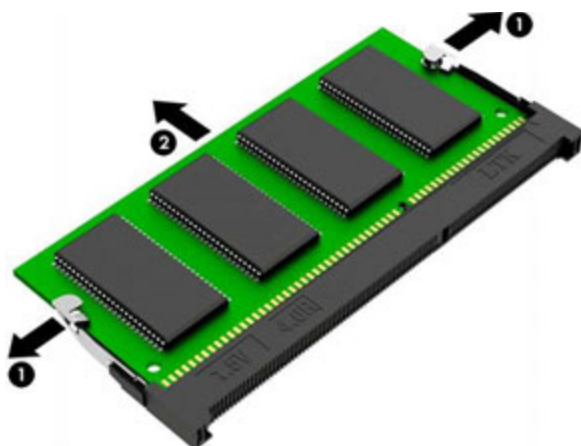
プライマリメモリモジュールは、システムボードの下部にあります。セカンダリメモリモジュールは、システムボードの上部にあります。

以下の手順でメモリ モジュールを取り外します。

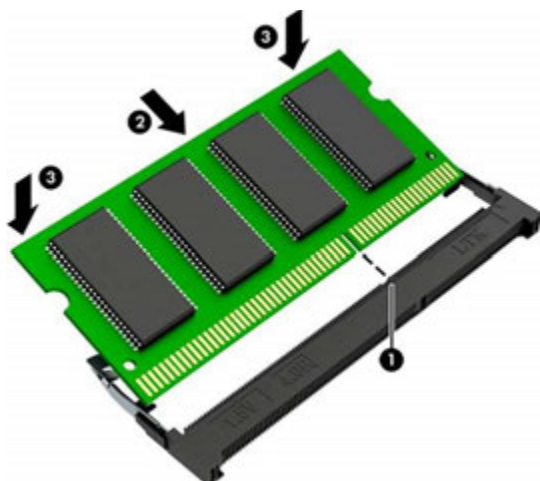
1. システム ボードの上部にあるセカンダリ メモリ モジュールにアクセスするには：ファンを上に向けて立てた状態のままにしてから、メモリ カバーを持ち上げてメモリ モジュールから取り外します。




2. システム ボードの下部にあるプライマリ メモリ モジュールにアクセスするには：底面カバーを取り外します ([34ページの「底面カバー」](#)を参照してください)。
3. SODIMMを取り外すには、SODIMMの両側にある2つのラッチを外側に押してから (1)、SODIMMをソケットから引き出します (2)。



- 新しいSODIMMを、切り込みの位置 (1) を確認しながら約30度の角度 (2) でソケット内にスライドさせてから、ラッチで所定の位置にロックされるまでSODIMMを押し下げます (3)。



 **注：**メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリ モジュールの切り込みとメモリ ソケットのタブを合わせます。

ワークステーションの電源を入れると、ワークステーションによって追加のメモリが自動的に認識されます。

ソリッドステート ドライブ

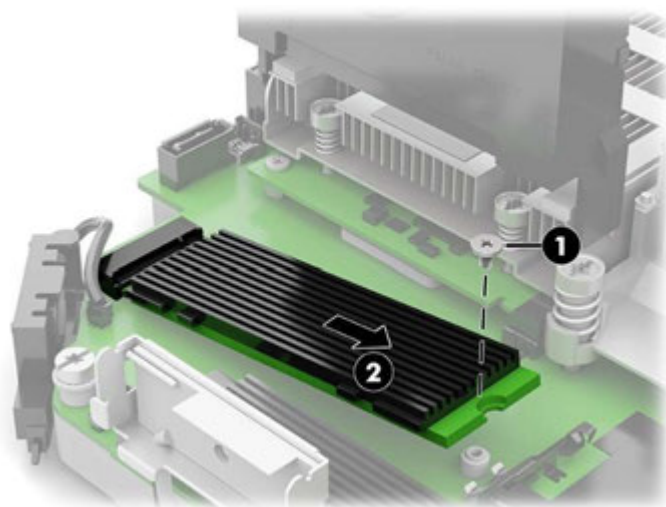
ソリッドステート ドライブを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

ソリッドステート ドライブを取り外す前に、以下の操作を行います。

- 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します ([17ページの「部品取り外しの準備」](#))。
- 上面カバーを取り外します ([18ページの「上面カバー」](#)を参照してください)。
- ソリッドステート ドライブの位置を確認します ([18ページの「内部部品の位置の確認」](#))。

以下の手順でソリッドステート ドライブを取り外します。


- ドライブをシステム ボードに固定しているネジ (1) を外します。
- ドライブをシステム ボード コネクタから引き出します (2)。両方のドライブに同じ取り外し手順を使用します。



ソリッドステート ドライブを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

ハードディスク ドライブ

ハードディスク ドライブを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

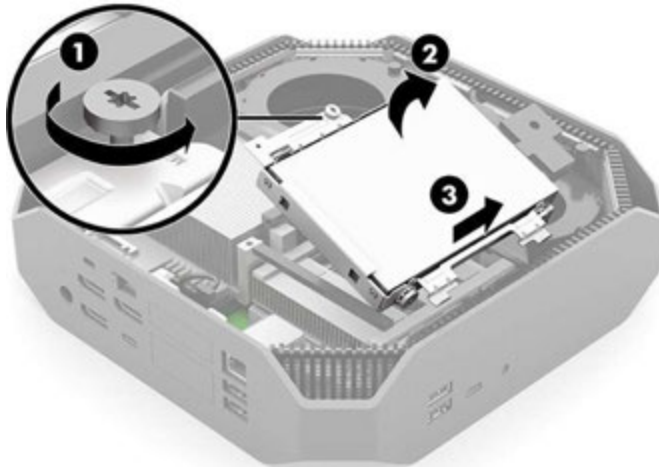
 **注：**古いハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にハードディスク ドライブ内のデータをバックアップしておいてください。

ハードディスク ドライブを取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)）。

以下の手順でハードディスク ドライブを取り外します。

1. ケーブルをハードディスク ドライブから外します。
2. ハードディスク ドライブを固定している固定用トルクス ネジを緩めます（1）。
3. ハードディスク ドライブ アセンブリを上引き上げるように回転させて（2）、ワークステーションから取り出します（3）。



4. ハードディスク ドライブをドライブ ケージに固定している4本のトルクス ネジを取り外します（1）。
5. ドライブ ケージからハードディスク ドライブを取り出します（2）。



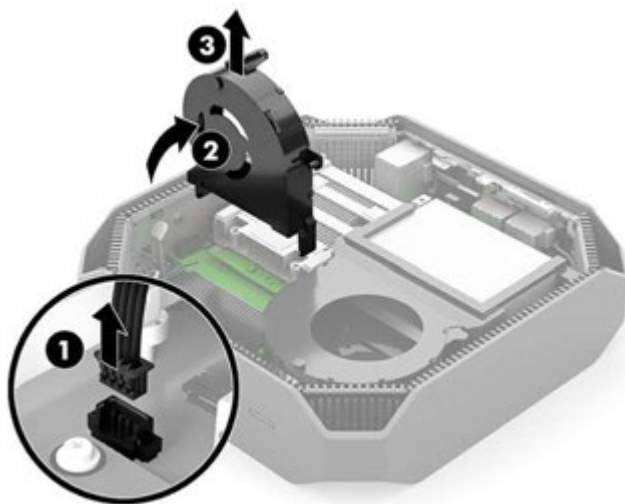
グラフィックスファン、ヒートシンク、およびカード

グラフィックスファン、ヒートシンク、およびカードを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。
グラフィックスカードを取り外す前に、以下の操作を行います。

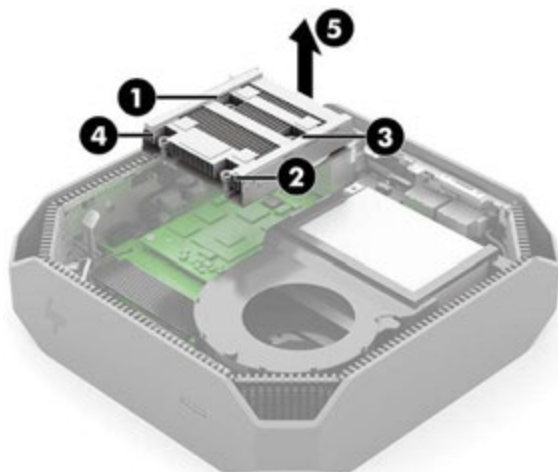
1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。

以下の手順でグラフィックスファン、ヒートシンク、およびカードを取り外します。

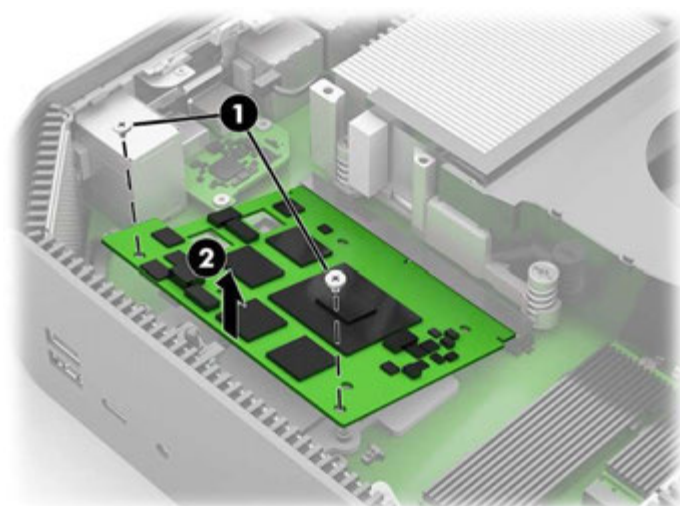
1. ファンケーブルをシステムボードから外します（1）。
2. ファンの上部をまっすぐ上に回転させて（2）、ワークステーションからファンを取り外します（3）。



3. ヒート シンクをワークステーションに固定している4本の固定用プラス ネジ (1) ~ (4) を、ヒート シンクに記載されている順序で緩めます。
4. ワークステーションからヒート シンクを取り外します (5)。



5. グラフィックス カードから2本のプラス ネジ (1) を外し、カードを上方向に回転させてソケットから取り外します (2)。



グラフィックス カードを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

スピーカー

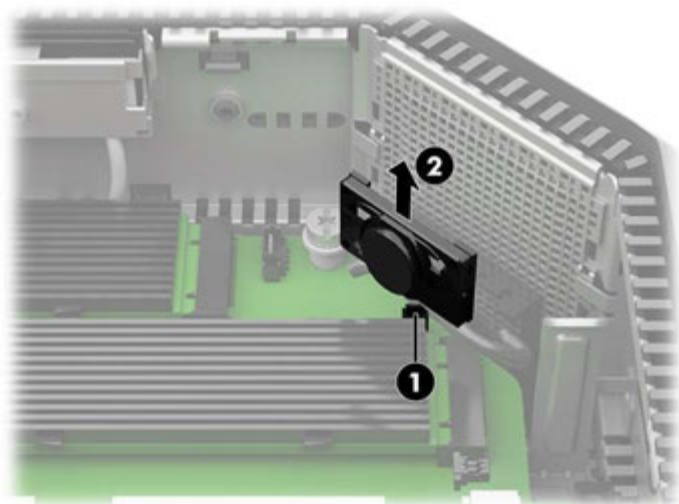
スピーカーを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

スピーカーを取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します ([17ページの「部品取り外しの準備」](#))。
2. 上面カバーを取り外します ([18ページの「上面カバー」](#)を参照してください)。

以下の手順でスピーカーを取り外します。

1. スピーカー ケーブル (1) をシステム ボード コネクタから外します。
2. スピーカーを引き上げてワークステーションから取り外します (2)。



スピーカーを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

ファン

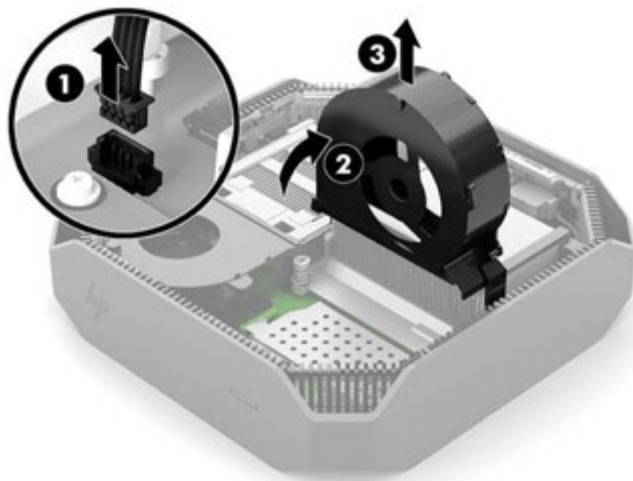
ファンを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

ファンを取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します (17ページの「部品取り外しの準備」)。
2. 上面カバーを取り外します (18ページの「上面カバー」を参照してください)。

以下の手順でファンを取り外します。

1. ファン ケーブルをシステム ボード コネクタから外します (1)。
2. ファンの上部をまっすぐ上に回転させて (2)、ワークステーションから取り外します (3)。



ファンを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

温度センサー

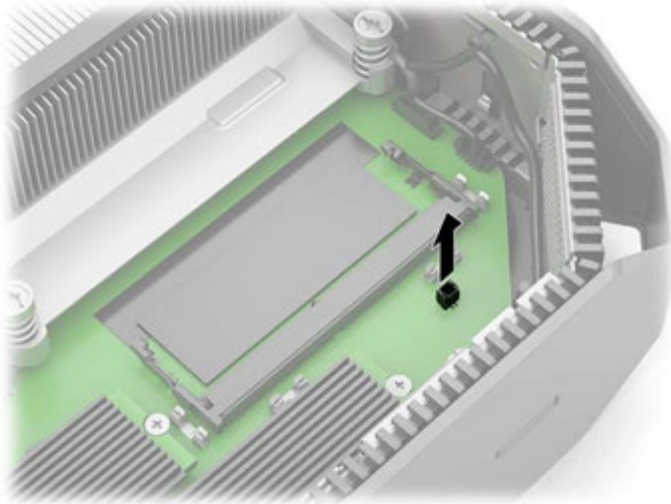
温度センサーを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

温度センサーを取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。
3. ファンを取り外します（[26ページの「ファン」](#)）。

以下の手順で温度センサーを取り外します。

- ▲ 温度センサーをまっすぐ上に引き上げて、システムボードから外します。



温度センサーを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

背面のポート拡張ボード

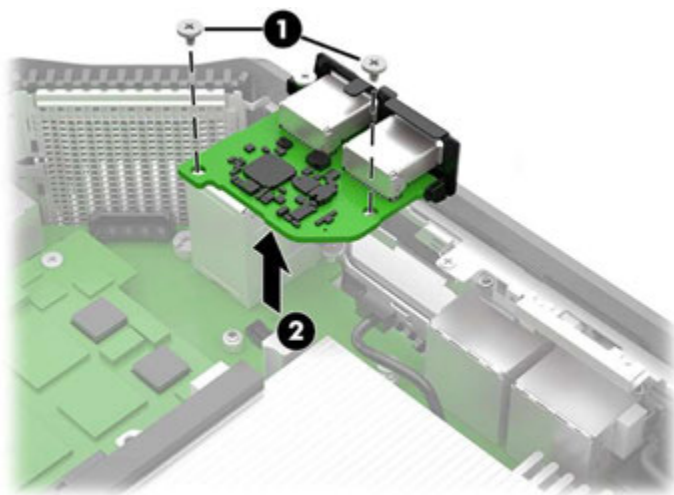
背面のポート拡張ボードを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

背面のポート拡張ボードを取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。

以下の手順で背面のポート拡張ボードを取り外します。

- ▲ ボードをワークステーションに固定している2本のプラス ネジ (1) を取り外し、ボードを持ち上げてシステム ボード上のコネクタから外します (2)。ボードを外すには、工具を使用する必要があります。



背面のポート拡張ボードを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

プロセッサ ヒート シンク

プロセッサ ヒート シンクを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

 **重要：** ヒート シンクとプロセッサ間の接着が非常に強いことがあります。

ワークステーションの電源が入る場合は、ヒート シンクを取り外す前に、ヒート シンクが温まるまでワークステーションの電源を入れたままにしておいてください。ヒート シンクが温まると、ヒート シンクとプロセッサ間の接着が弱まり、それらを切り離すことが容易になります。


ヒート シンクを持ち上げるときは（取り外す前にヒート シンクを温めることができない場合は特に）、プロセッサをソケットから引き出さないように注意してください。プロセッサを誤って取り外すと、ピンが損傷するおそれがあります。

ヒート シンクを取り外す前に、以下の操作を行います。


1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。
3. ファンを取り外します（[26ページの「ファン」](#)）。

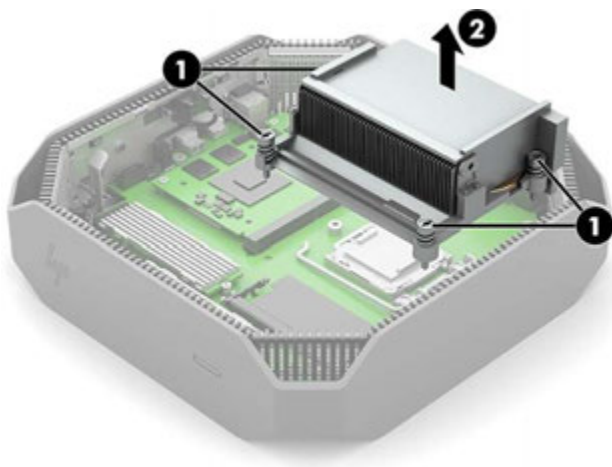
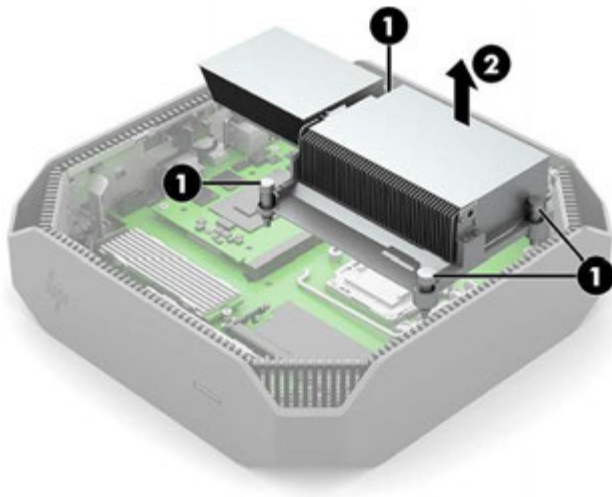
以下の手順でプロセッサ ヒート シンクを取り外します。

1. ヒート シンクに記載されている順序で、4本の固定用トルクス ネジ (1) を緩めます。
2. ワークステーションからヒート シンクを取り外します (2)。

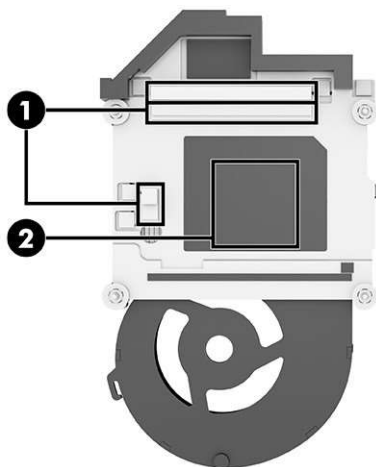
 **重要：** 必ずヒート シンクに刻印されている番号順にネジを緩めてください。


重要： 最適な放熱性能を確保するため、プロセッサまたはヒート シンク表面の放熱グリースに触れないよう注意してください。

 **注：** お使いのワークステーションに適合するヒート シンクを参照してください。



3. ヒートシンクを取り外すたびに、ヒートシンクおよびシステムボードコンポーネントの表面から放熱材料を完全に取り除いてください。交換用の放熱材料は、ヒートシンクおよびシステムボードのスペア部品キットに含まれています。以下の図は、交換用の放熱材料の位置を示しています。ヒートシンクには、放熱パッド（1）および放熱ペースト（2）が使用されています。



 **重要：**システムボードの交換が必要になる可能性のある損傷を避けるために、ヒートシンクの固定ネジを斜め向かいどうしで（Xのように対角線で）締めて、ヒートシンクをプロセッサに均等に取り付けます。

プロセッサヒートシンクを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

プロセッサ


プロセッサを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

プロセッサを取り外す前に、以下の操作を行います。

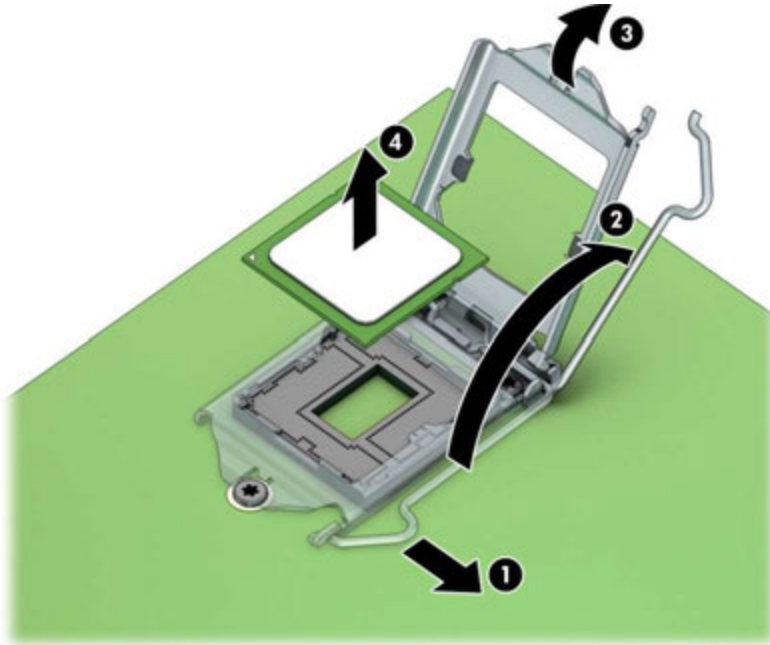
1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。
3. ファンを取り外します（[26ページの「ファン」](#)）。
4. ヒートシンクを取り外します（[28ページの「プロセッサヒートシンク」](#)）。

以下の手順でプロセッサを取り外します。


1. ロック レバーをプロセッサから引き離し (1)、レバーを完全に開いた位置まで回転させます (2)。
2. マイクロプロセッサ リテーナーを持ち上げて、完全に開いた位置まで回転させます (3)。
3. プロセッサをソケットから慎重に持ち上げます (4)。

 **重要：**プロセッサ ソケット内のピンには触らないでください。これらのピンは壊れやすいため、触ると回復不能な損傷が生じるおそれがあります。ピンが損傷している場合は、システム ボードの交換が必要になることがあります。

プロセッサのはんだ接続部への損傷を防ぐため、ヒート シンクの取り付けは、プロセッサを取り付けてから24時間以内に行う必要があります。



プロセッサを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

 **注：**新しいプロセッサをシステム ボードに取り付けた後は、必ずシステムROMを更新して、最新バージョンのBIOSがワークステーションで使用されているようにしてください。詳しくは、HPのサポート Webサイト、<https://support.hp.com/jp-ja/document/c06366640/> を参照してください。

電源ボタン ボード

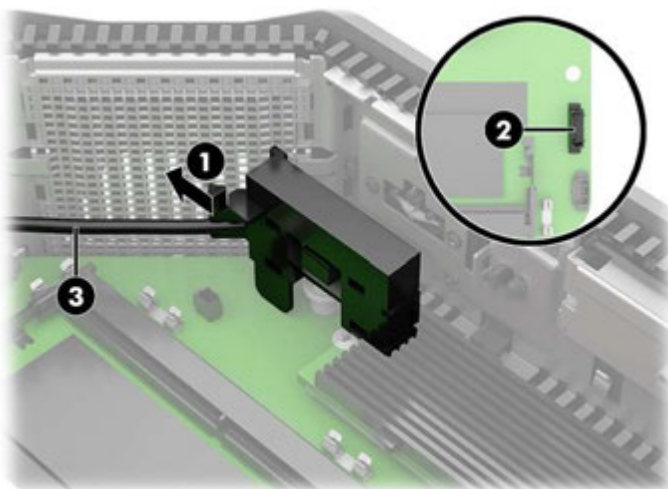
電源ボタン ボードを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

電源ボタン ボードを取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します ([17ページの「部品取り外しの準備」](#))。
2. 上面カバーを取り外します ([18ページの「上面カバー」](#)を参照してください)。
3. ファンを取り外します ([26ページの「ファン」](#))。

以下の手順で電源ボタン ボードを取り外します。


1. ボードの側面を引いて外します (1)。
2. ケーブル (2) をシステム ボードから外します。
3. ワークステーションの側面にある配線からケーブル (3) を引き出し、ワークステーションからボードを取り外します。



電源ボタン ボードを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

システム ボード

システム ボードを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

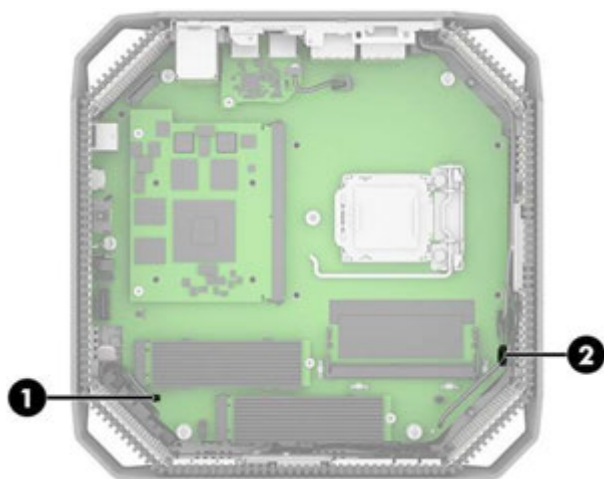
 **注：**システム ボードのすべてのスペア部品キットには、交換用の放熱材料が含まれています。

システム ボードを取り外す前に、以下の操作を行います。

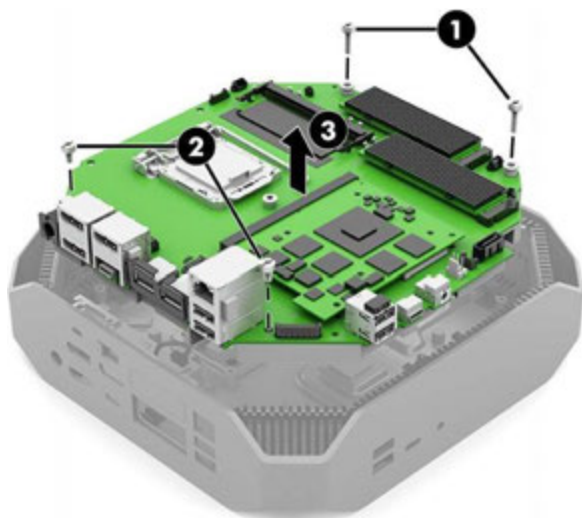
1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します ([17ページの「部品取り外しの準備」](#))。
2. 上面カバーを取り外します ([18ページの「上面カバー」](#)を参照してください)。
3. 底面カバーを取り外します ([34ページの「底面カバー」](#)を参照してください)。
4. (システム ボードの上部と下部にある) メモリ モジュールを取り外します ([19ページの「メモリ モジュール \(SODIMM\)」](#))。
5. 該当する場合は、ハードディスク ドライブを取り外します ([23ページの「ハードディスク ドライブ」](#))。
6. ファンを取り外します ([26ページの「ファン」](#))。
7. 温度センサーを取り外します ([27ページの「温度センサー」](#))。
8. グラフィックス ファン、グラフィックス ヒート シンク、およびグラフィックス カードを取り外します ([24ページの「グラフィックス ファン、ヒート シンク、およびカード」](#))。
9. 該当する場合は、背面のポート 拡張ボードを取り外します ([27ページの「背面のポート 拡張ボード」](#))。
10. プロセッサ ヒート シンクを取り外します ([28ページの「プロセッサ ヒート シンク」](#))。
11. プロセッサを取り外します ([30ページの「プロセッサ」](#))。
12. (システム ボードの下部から) 無線LANモジュールを取り外します ([35ページの「無線LANモジュール」](#))。

以下の手順でシステム ボードを取り外します。


1. スピーカー ケーブル (1) をシステム ボードから外します。
2. 電源ボタン ボードケーブル (2) をシステム ボードから外します。



3. システム ボードの前面から2本の長いネジ (1) を外します。
4. システム ボードの背面から2本の短いネジ (2) を外します。
5. ワークステーションからシステム ボードを取り外します (3)。



システム ボードを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

 **注：**システム ボードを交換するときは、BIOSでシャーシのシリアル番号を変更する必要があります。

システム ボードを交換するときは、影響を受けるワークステーションに関するSMBIOS情報を設定しない必要があります。ボードの再設定に失敗すると、（ワークステーションをアクティベーションしない必要がある場合に）アクティベーションに失敗したり、システムの回復に失敗したりするなど、最終的にエラーが発生します。

[HP Computer Setup]でSMBIOS情報を更新します。

底面カバー

底面カバーを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。

底面カバーを取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。

以下の手順で底面カバーを取り外します。

- ▲ ワークステーションの内部から、底面カバーのリリース ラッチを押して（1）、底面カバーをワークステーションから引き上げます（2）。



底面カバーを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

電池

電池はシステム ボードの下部にあります。お使いのワークステーションに付属の電池は、リアルタイム クロック（RTC）に電力を供給するためのものです。電池は消耗品です。電池を交換するときは、ワークステーションに最初に取り付けられていたものと同等の電池を使用してください。ワークステーションに付属の電池は、3Vのボタン型リチウム電池です。

警告！ お使いのワークステーションには、二酸化マンガン リチウム電池が内蔵されています。電池の取り扱いを誤ると、火災ややけどなどの危険があります。けがをすることがないように、以下の点に注意してください。

- 電池を充電しないでください。
- 60℃を超える場所に電池を放置しないでください。
- 電池を分解したり、つぶしたり、ショートさせたり、火中や水に投げたりしないでください。
- 電池を交換するときは、ワークステーションに最初に取り付けられていたものと同等の電池を使用してください。

重要： 電池を交換する前に、ワークステーションのCMOS設定のバックアップを作成してください。電池が取り出されたり交換されたりするときに、CMOS設定がクリアされます。

静電気の放電によって、ワークステーションや別売の電子部品が破損することがあります。作業を始める前に、アース（接地）された金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。



注：ワークステーションを電源コンセントに差し込むことで、リチウム電池の寿命を延長できます。リチウム電池は、ワークステーションが外部電源に接続されていない場合にのみ使用されます。

HPでは、使用済みの電子機器やHP製インク カートリッジのリサイクルを推奨しています。日本でのリサイクル プログラム について詳しくは、<https://www8.hp.com/jp/ia/hp-information/supplies-recycling/business.html> を参照してください。日本以外の国や地域のHPでのリサイクル プログラムについて詳しくは、<http://www.hp.com/recycle/>（英語サイト）を参照してください。

電池を取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。
3. 底面カバーを取り外します（[34ページの「底面カバー」](#)）。
4. RTC用電池の位置を確認します（[18ページの「内部部品の位置の確認」](#)）。

以下の操作で電池を取り外します。

1. 電池をホルダーから取り出すために、電池の一方の端の上にある留め金を押します（1）。電池が持ち上がったら、ホルダーから取り出します（2）。



2. 交換する電池を、[+]と書かれている面を上にして正しい位置に装着します。電池は電池ホルダーによって自動的に正しい位置に固定されます。

無線LANモジュール

無線LANモジュールを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。


無線LANモジュールは、システム ボードの下部にあります。

無線LANモジュールを取り外す前に、以下の操作を行います。

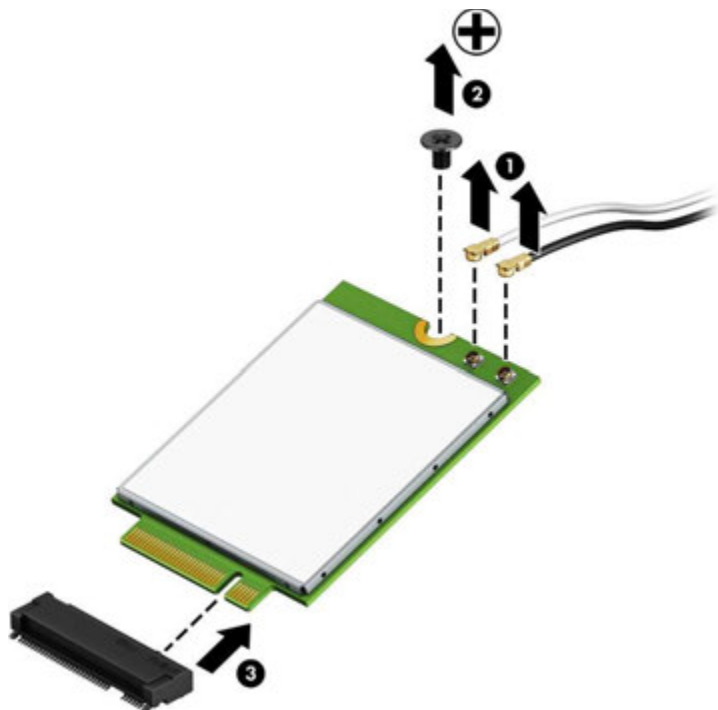
1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。
3. 底面カバーを取り外します（[34ページの「底面カバー」](#)）。
4. 無線LANモジュールの位置を確認します（[18ページの「内部部品の位置の確認」](#)）。

以下の手順で無線LANモジュールを取り外します。

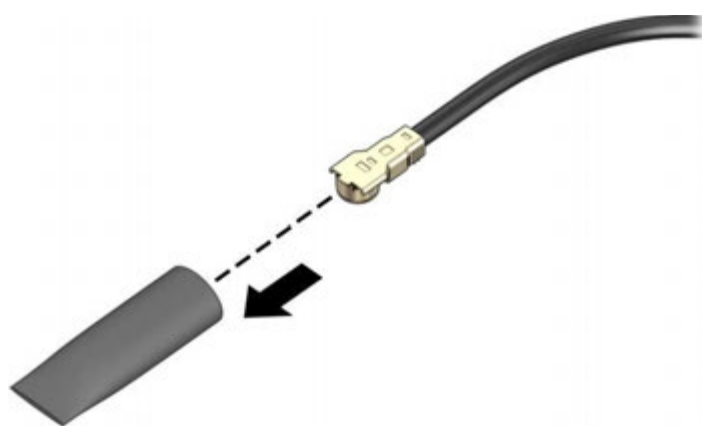
1. アンテナ ケーブルをモジュールから外します (1)。

 **注：** 1/MAINというラベルの付いた無線LANアンテナ ケーブルは、無線LANモジュールの主端子に接続されています。2/AUXというラベルの付いた無線LANアンテナ ケーブルは、無線LANモジュールの補助端子に接続されています。


2. モジュールをワークステーションに固定しているネジを取り外します (2)。
3. モジュールを引っ張ってソケットから取り外します (3)。



4. 無線LANアンテナが無線LANモジュールの端子に接続されていない場合は、以下の図に示すように、アンテナ コネクタに保護スリーブを取り付ける必要があります。



無線LANモジュールを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

 **注：** 無線LANモジュールは、誤挿入を防ぐために切り込みを付けるように設計されています。

無線アンテナおよびケーブル

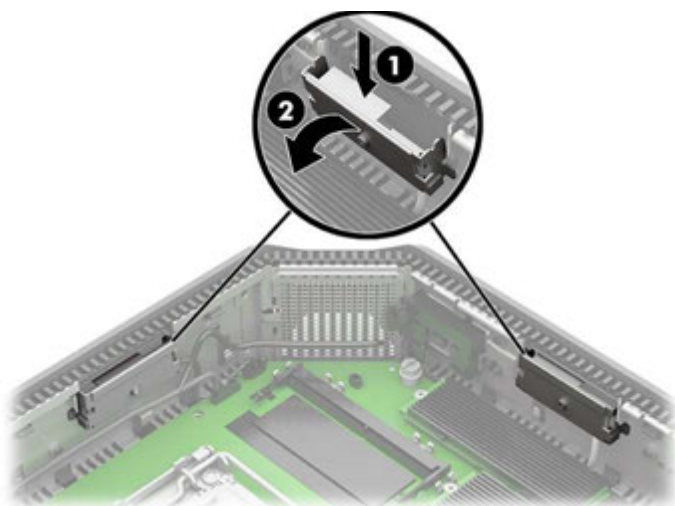
無線アンテナおよびケーブルを取り外すには、以下の手順に沿って操作します。これらのケーブルは、システムボードの下部にある無線LANモジュールから、ワークステーションの上部に取り付けられているアンテナに配線されます。

無線アンテナおよびケーブルを取り外す前に、以下の操作を行います。

1. 部品を取り外せるようにワークステーションを準備します（[17ページの「部品取り外しの準備」](#)）。
2. 上面カバーを取り外します（[18ページの「上面カバー」](#)を参照してください）。
3. 底面カバーを取り外します（[34ページの「底面カバー」](#)を参照してください）。
4. ファンを取り外します（[26ページの「ファン」](#)）。
5. グラフィックス ヒート シンクを取り外します（[24ページの「グラフィックス ファン、ヒート シンク、およびカード」](#)）。
6. プロセッサ ヒート シンクを取り外します（[28ページの「プロセッサ ヒート シンク」](#)）。
7. アンテナ ケーブルを無線LANモジュールから外します（[35ページの「無線LANモジュール」](#)）。

以下の手順で無線アンテナを取り外します。

1. アンテナをシャーシに固定している保持クリップを押し下げます（1）。
2. アンテナ クリップを回転させてシャーシから離し（2）、アンテナを取り外します。



3. シャーシの下部への配線からアンテナ ケーブルを引き出します。

無線アンテナおよびケーブルを取り付けるには、取り外し手順を逆に行います。

5 コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ ([HP Computer Setup])

ここでは、[HP Computer Setup]について詳しく説明します。

- 設定を初期設定から変更する、または初期設定に戻す
- システム構成（プロセッサ、グラフィックス、メモリ、オーディオ、記憶装置、通信コネクタ、入力装置など）の表示
- 起動可能なデバイスのブート順序の変更。起動可能なデバイスとしては、ハードディスク ドライブ、USBフラッシュ メディア デバイスなどがあります
- 会社によって割り当てられたアセットタグまたは資産ID番号の設定
- システムの起動時だけでなく、再起動時の電源投入時パスワード入力画面の有効化
- 管理者パスワードの設定。このパスワードは[HP Computer Setup]およびこのガイドで説明する設定にアクセスする場合に使用します
- 有効なパスワードの最小要件の設定（長さ、必要な文字種など）
- シリアル コネクタ、USBコネクタ、オーディオ、内蔵NIC（ネットワーク インターフェイス コントローラー）などの内蔵I/O機能の使用禁止/許可の設定
- さまざまな種類のブートソースの有効/無効の設定
- セキュア ブート、電源管理、仮想化サポート、セットアップおよびPOSTで使用する言語およびキーボードの種類の設定
- システムのセットアップ情報の複製。システムの設定情報をUSBデバイスに保存して、1台以上のワークステーションにコピーできます
- ドライブロック セキュリティの有効/無効の設定またはハードディスク ドライブの安全な消去（ドライブでサポートされている場合）

[HP Computer Setup]の使用


[HP Computer Setup]にはワークステーションの電源を入れるか再起動することでのみアクセスできます。


[HP Computer Setup]を起動するには、以下の操作を行います。

1. ワークステーションの電源を入れるか再起動します。
2. 電源ボタン ランプが白色に点灯したら[F10]キーを繰り返し押して、ユーティリティにアクセスします。

また、[Esc]キーを押してメニューを表示し、起動時に利用できる[HP Computer Setup]などのさまざまなオプションを利用することもできます。

[HP Computer Setup]のメイン画面から4つのメニュー[Main]（メイン）、[Security]（セキュリティ）、[Advanced]（カスタム）、[UEFI Drivers]（UEFIドライバー）を選択できます。


 **注：**適切なタイミングで[F10]キーを押せなかった場合は、ワークステーションを再起動して、電源ボタン ランプが白色に点灯したときに再度[F10]キーを繰り返し押します。

 **注：**[UEFI Drivers]（UEFIドライバー）を選択するとワークステーションが再起動し、他社製のオプションROM管理用アプリケーションが起動します。このアプリケーションに直接アクセスするには、起動時に[F3]キーを押します。


3. 左右の矢印キーでメニューを選択し、上下の矢印キーで項目を選んで[Enter]キーを押します。[HP

Computer Setup]のメイン画面に戻るには、[Esc]キーを押します。

4. 変更した設定を有効にして保存するには、[Main]→[Save Changes and Exit]（変更を保存して終了）の順に選択します。
 - 変更した設定を破棄したい場合は、[Ignore Changes and Exit]（変更を保存しないで終了）を選択します。
 - [Advanced]および[Main]メニューの設定を元の値に戻すには、[Apply Factory Defaults and Exit]（初期設定を適用して終了）を選択します。
 - [Advanced]および[Main]メニューの設定を以前に[Save Custom Defaults]（カスタムの初期設定の保存）で保存した設定に戻すには、[Apply Factory Defaults and Exit]（初期設定を適用して終了）を選択します。カスタムの初期設定が保存されていない場合は、工場出荷時の初期設定が使用されます。

 **注：** [Apply Defaults]（初期設定に設定）を選択しても、[Security]メニューの設定を変更することはできません。これらの値をリセットするには、[Security]メニューの下部にある[Restore Security Settings to Factory Defaults]（セキュリティ設定を工場出荷時設定に復元する）を選択します。

 **注：** モデルによっては、以下のセクションで説明する一部の設定が表示されない場合があります。

 **重要：** 設定の破損を防ぐため、[HP Computer Setup]での変更がBIOSに保存されている最中に、ワークステーションの電源を切らないでください。[HP Computer Setup]の終了後にのみ、安全にワークステーションの電源を切ることができます。

[HP Computer Setup] : [Main]（メイン）

以下の表では、[HP Computer Setup]の[Main]メニューについて説明します。


 **注：** [HP Computer Setup]でサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

表5-1 [HP Computer Setup] : [Main]

項目	説明
System Information （システム情報）	<p>[Advanced System Information]（詳細システム情報）が選択されている場合、以下の項目が一覧表示されます。[Basic System Information]（基本システム情報）が選択されている場合、一覧表示される項目が少なくなります</p> <ul style="list-style-type: none">● Product name（製品名）● Installed memory size（インストールされているメモリ サイズ）● Processor type（プロセッサの種類）● Processor cache size（プロセッサのキャッシュ サイズ）（L1/L2/L3）● Processor speed（プロセッサ速度）● MicroCode revision（MicroCodeのリビジョン）● Processor stepping（プロセッサ ステッピング）● Memory speed（メモリ速度）● DIMM size（DIMMサイズ）（取り付けられているモジュールごと）● System BIOS version（システムBIOSバージョン）● ME Firmware version（MEファームウェア バージョン）（インテルのみ）● Video BIOS version（ビデオBIOSのバージョン）● Reference code revision（リファレンス コードのリビジョン）● Super I/O firmware version（スーパーI/Oファームウェアのバージョン）● USB Type-C controller firmware version（USB Type-Cコントローラー ファームウェアのバージョン）● Serial number（シリアル番号）● SKU number（SKU番号）

表5-1 [HP Computer Setup] : [Main]（続き）

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • UUID (Universally Unique Identifier) (ユニバーサル固有識別子) • Asset Tracking Number (アセットトラッキング番号) • Feature byte (フィーチャー バイト) • Build ID (ビルドID) • Product family (製品ファミリ) • System board ID (システム ボードID) • System board CT number (システムボードのCT番号) • Integrated MAC Address (内蔵MACアドレス)
System Diagnostics (システム診断)	<p>ハードディスク ドライブに[HP Advanced Diagnostics]がインストールされている場合、アプリケーションが起動します。[HP Advanced Diagnostics]がインストールされていない場合、BIOSに内蔵されている基本バージョンにより、以下を実行する機能が提供されます</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memory Test (メモリ テスト) • Hard Drive Check (ハードディスク ドライブ チェック) • Language (言語)
Update System BIOS (システムBIOSの更新)	<p>http://www.hp.com/ または別のネットワーク サーバー、リムーバブルUSBドライブ、ハードディスク ドライブ上に存在するファイルのどれからシステムBIOSを更新できます</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check [current selection] for BIOS Updates (<現在の選択>でBIOS更新プログラムを確認) ここに表示される文字列は、[BIOS Update Preferences] (BIOSの更新の設定) での設定によって異なります • Lock BIOS Version (BIOSのバージョンのロック) このオプションを選択すると、システムが現在のBIOSバージョンにロックされ、更新はできなくなります • BIOS Rollback Policy (BIOSのロールバック ポリシー) <ul style="list-style-type: none"> ■ Unrestricted Rollback to older BIOS (古いBIOSへの無制限のロールバック) : 以前のどのバージョンのBIOSにもロールバックできます ■ Restricted Rollback to older BIOS (古いBIOSへの制限付きロールバック) : これを選択すると、[Minimum BIOS Version] (最小のBIOSバージョン) がアクティブになり、ロールバックできる最小のBIOSバージョンを手動で入力できます • Allow BIOS Updates Using a Network (ネットワークを使用したBIOSの更新を許可) • BIOS Update Preferences (BIOSの更新の設定) <ul style="list-style-type: none"> ■ Check for Update on Next Reboot (次の再起動時に更新を確認) : 初期設定では無効になっています ■ BIOS Source (BIOSソース) : HP.comまたはカスタムURLのどちらかを選択できます。[Custom URL] (カスタムURL) を選択すると、[Edit Custom URL] (カスタムURLの編集) がアクティブになります。カスタムURLは、マネージドIT環境でのみ使用することをおすすめします ■ Automatic BIOS Update Setting (BIOSの自動更新設定) 更新の定期的な確認について構成できます 注 : Microsoft® Windows® のBitLockerドライブ暗号化 (BDE) が有効になっている場合は、BIOSのフラッシュ前にこの機能を一時的に中断する必要があります ■ Do not update (更新しない) ■ Checking for updates and prompt the user to accept or reject the update at that time (更新を確認し、その時点での更新を承諾するか拒否するかをユーザーに尋ねる) ■ Checking for updates and install all new versions (更新を確認し、新しいバージョンをすべてインストールする) ■ Checking for updates and install only new versions marked important (更新を確認し、重要とマーク付けされている新しいバージョンのみをインストールする) ■ BIOS Update Frequency (BIOSの更新の頻度) <ul style="list-style-type: none"> ■ Daily (毎日) ■ Weekly (毎週) ■ Monthly (毎月) (初期設定)

表5-1 [HP Computer Setup] : [Main] (続き)

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> Network Configuration Settings (ネットワーク構成の設定) Update BIOS Using Local Media (ローカルメディアでBIOSを更新) USBストレージまたはハードディスクドライブにあるファイルにアクセスできます。 Http://www.hp.com/にあるBIOS Softpaqに含まれている[HP BIOS Update and Recovery]アプリケーションは、ハードディスクドライブまたはUSBデバイス上の適切な場所にBIOSファイルをコピーします
Change date and time (日付および時刻の変更)	システムの日付と時刻を更新できます
Set machine unique data (システムの固有データを設定)	フィーチャー バイト、ビルドID、シリアル番号、SKU番号、製品ファミリ、システム ボードのCT番号、製品名など、各システムに固有のデータを設定または表示できます
System IDs (システムID)	以下の値を設定できます <ul style="list-style-type: none"> Asset Tracking Number (アセットトラッキング番号) Ownership Tag (オーナーシップタグ)
Replicated Setup (複製セッアップ)	Backup current settings to USB device (現在の設定をUSBデバイスにバックアップする) フォーマットされたUSBフラッシュ メディア デバイスにシステム設定値を保存します Restore current settings from USB device (現在の設定をUSBデバイスから復元する) USBフラッシュ メディア デバイスに保存されているシステム設定値を復元します
Save Custom Defaults (カスタマイズした初期設定を保存)	現在のシステム構成の設定をカスタム初期設定のセットとして保存します
Apply Custom Defaults and Exit (カスタマイズした初期設定を適用して終了)	再起動後、ワークステーションにカスタム初期設定を適用します。[Security] (セキュリティ) メニューのオプションには適用されません
Apply Factory Defaults and Exit (工場出荷時設定を適用して終了)	再起動後、ワークステーションに出荷時のシステム構成の設定を復元します。[Security]メニューのオプションには適用されません
Ignore Changes and Exit (変更を保存しないで終了)	変更した設定値を破棄し、[HP Computer Setup]を終了します
Save Changes and Exit (変更を保存して終了)	変更した現在のシステム構成を保存し、[HP Computer Setup]を終了し、再起動します
Suppress POST errors (POSTエラーを抑制)	選択すると、起動中にPOST (電源投入時のセルフテスト) によって生成されたエラーがすべてオフになります

[HP Computer Setup] : [Security] (セキュリティ)

以下の表では、[HP Computer Setup]の[Security]メニューについて説明します。


 **注：** [HP Computer Setup]でサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

表5-2 [HP Computer Setup] : [Security]

項目	説明
Create BIOS Administrator Password (BIOS管理者パスワードの作成)	<p>以下の機能へのアクセスを制御するBIOS管理者パスワードを設定して有効にします</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [HP Computer Setup]のメニュー (F10) ● 他社製のオプションROM管理 (F3) ● システムROMの更新 ● システム設定を変更するWMIコマンド ● [HP BIOS Configuration Utility] (BCU) ● 代替の電源投入時パスワード <p>注 : BIOSユーザーを作成すると、[Fast Boot] (高速起動) オプションが無効になります</p> <p>注 : パスワードを設定すると、[HP Computer Setup]の設定を変更したり、BIOSを更新したり、Windows環境で特定のプラグ アンド プレイ設定を変更したりする必要があります</p>
Change BIOS Administrator Password (BIOS管理者パスワードの変更) (BIOS管理者パスワードが設定されている場合にのみアクティブになります)	<p>BIOS管理者パスワードを変更できます</p> <p>変更するためには、現在のパスワードを知っている必要があります</p>
Create POST Power-On Password (POST電源投入時パスワードの作成)	<p>電源を入れなおすか再起動したときに、電源投入時パスワードの入力画面が表示されます。</p> <p>ユーザーが正しい電源投入時パスワードを入力しない場合は、装置は起動されません</p>
Change POST Power-On Password (POST電源投入時パスワードの変更) (BIOS管理者パスワードが設定されている場合にのみアクティブになります)	<p>POST電源投入時パスワードを変更できます</p> <p>変更するためには、現在のパスワードを知っている必要があります</p>
Password Policies (パスワードポリシー)	<p>有効なパスワードのガイドラインを設定できます。オプションには、以下のものが含まれます</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Password minimum length (パスワードの最小長) ● Requires at least one symbol (最低1つの記号が必要) ● Requires at least one number (最低1つの数字が必要) ● Requires at least one uppercase character (最低1つの大文字が必要) ● Requires at least one lowercase character (最低1つの小文字が必要) ● Allow spaces (スペースを許可する) <p>Clear Password Jumper (パスワードクリア ジャンパー)</p> <p>起動時にパスワードをクリアするパスワード ジャンパーがない状態を許可する場合は[Honor] (承認) を、許可しない場合は[Ignore] (無視) を選択します。初期設定では[Honor]になっています</p>
Security Configuration (セキュリティ構成)	<p>TPM Embedded Security (TPM内蔵セキュリティ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TPM Specification Version (TPM仕様のバージョン) 現在のTPMバージョンを表示します ● TPM Device (TPMデバイス) TPM (Trusted Platform Module) を使用可能または非表示に設定できます ● TPM State (TPMの状態) 選択すると、TPMが有効になります ● Clear TPM (TPMのクリア) 選択すると、TPMが未所有状態にリセットされます。TPMはクリアされた後でオフになります。TPM操作を一時的に中断するには、TPMをクリアするのではなく、オフにします <p>重要 : TPMをクリアすると、TPMは工場出荷時の初期設定にリセットされ、オフになります。作成されたすべての鍵と、その鍵によって保護されているデータが失われます</p>

表5-2 [HP Computer Setup] : [Security] (続き)

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ● TPM Activation Policy (TPM有効化のポリシー) <ul style="list-style-type: none"> ○ F1 to boot (F1で起動) ○ Allow user to reject (ユーザーによる拒否を許可) ○ No prompts (ユーザー入力を要求しない)
	BIOS Sure Start
	<ul style="list-style-type: none"> ● Verify Boot Block on every Boot (起動のたびにブート ブロックを確認) : 選択すると、[HP Sure Start]が有効になります ● Dynamic Runtime Scanning of Boot Block (ブート ブロックの動的ランタイム スキャン) : ワークステーションが動作している間、1時間に数回、BIOSブート ブロック領域の整合性を確認します。初期設定では有効になっています ● Sure Start BIOS Settings Protection (HP Sure StartによるBIOS設定の保護) : 有効にすると、[HP Sure Start]はすべての重要なBIOS設定をロックし、不揮発性 (フラッシュ) メモリを使用してそれらの設定の保護を強化します 注 : この設定を有効にするには、管理者パスワードを設定する必要があります ● Enhanced HP Firmware Runtime Intrusion Prevention and Detection (HPファームウェアのランタイム侵入防止および検知機能の強化) : オペレーティング システムの動作中にメイン メモリから実行されているHPシステム ファームウェアの監視を有効にします。オペレーティング システムの動作中にアクティブなHPシステム ファームウェアで異常が検出されると、[HP Sure Start]のセキュリティ イベントが生成されます ● Sure Start Security Event Policy (HP Sure Startのセキュリティ イベント ポリシー) : オペレーティング システムの動作中に重大なセキュリティ イベント (HPファームウェアへの変更) が検出されたときの[HP Sure Start]の動作を制御します <ul style="list-style-type: none"> — Log Event Only (イベントの記録のみ) : [HP Sure Start]では、すべての重大なセキュリティ イベントを[HP Sure Start]の不揮発性 (フラッシュ) メモリ内の[HP Sure Start]オーディオ ログに記録します — Log Event and notify user (イベントを記録してユーザーに通知) : [HP Sure Start]では、すべての重大なセキュリティ イベントの記録に加え、重大なイベントが発生したことをオペレーティング システム内のユーザーに通知します — Log Event and power off system (イベントを記録してシステムを電源切断) : [HP Sure Start]では、すべての重大なセキュリティ イベントの記録に加え、[HP Sure Start]セキュリティ イベントの検出と同時にワークステーションの電源を切断します。データが失われる可能性があるため、システムのセキュリティの整合性がデータ損失の可能性のあるリスクよりも優先される状況でのみ、この設定をおすすめします
	Smart Cover (スマート カバー)
	<ul style="list-style-type: none"> ● Cover Removal Sensor (カバー取り外しセンサー) : Disabled (無効) /Notify user (ユーザーに通知) /Administrator password (管理者パスワード)
	<p>カバー センサーを無効化、またはワークステーションのカバーが取り外された場合に実行されるアクションを設定できます。初期設定は[Disabled]です</p> <p>注 : [Notify user]に設定すると、センサーがカバーの取り外しを検出した後、最初の起動時にPOSTエラーをユーザーに警告します。パスワードが設定されている場合、[Administrator Password]に設定すると、カバーが取り外されたことをセンサーが検知した場合、ワークステーションを起動するときにパスワードの入力が要求されます</p>
	Intel Software Guard Extensions (インテル ソフトウェア・ガード・エクステンションズ) (SGX)
	<p>[インテルSGX]は、ユーザーレベルのコードでメモリのプライベート領域を割り当てることができるプロセッサ コード命令セットです。通常のプロセス メモリとは異なり、より高い特権レベルで実行されるプロセスからも保護されます</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Software control (ソフトウェア制御) ● Disable (無効) ● Enable (有効)
Utilities (ユーティリティ)	Hard Drive Utilities (ハードディスク ドライブ ユーティリティ) <ul style="list-style-type: none"> ● Save/Restore GPT of System Hard Drive (システムのハードディスク ドライブのGPTの保存/復元) この機能を有効にすると、システムのハードディスク ドライブのGUIDパーティション テーブル (GPT) が保存されます。その後GPTが変更された場合は、GPTを復元するかどうかを選択するよう求められます

表5-2 [HP Computer Setup] : [Security] (続き)

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ● DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/自動DriveLock) ハードディスク ドライブにマスター パスワードまたはユーザー パスワードを割り当てたり、パスワードを変更したりします。この機能が有効の場合は、POST実行中にどちらかのDriveLockパスワードを入力するよう求められます。どちらのパスワードも正常に入力されなかった場合は、次のコールド ブート シーケンスの間にどちらかのパスワードが入力されるまで、ハードディスク ドライブにはアクセスできません 注 : この項目は、DriveLock機能をサポートするハードディスク ドライブが少なくとも1台のシステムに接続されている場合にのみ表示されます 重要 : これらの設定はすぐに有効になることに注意してください。保存する必要はありません 重要 : DriveLockパスワードは記録しておいてください。[DriveLock]のパスワードを忘れると、ドライブは恒久的にロックされます ドライブの選択後、以下のオプションが利用可能になります。 <ul style="list-style-type: none"> – Set DriveLock Master Password (DriveLockのマスター パスワードの設定) : ドライブのマスター パスワードを設定しますが、マスター パスワードではDriveLockは有効になりません – Enable DriveLock (DriveLockの有効化) : ドライブのユーザー パスワードを設定し、DriveLockを有効にします ● Secure Erase (セキュリティ保護された消去) ハードディスク ドライブの完全消去を選択します [Secure Erase]ファームウェア コマンドを使用するプログラムでハードディスク ドライブを消去した後は、ファイル リカバリ プログラム、パーティション リカバリ プログラム、またはその他のデータ リカバリ方法でこのドライブからデータを抽出することはできません ● Allow OPAL Hard Drive SED Authentication (OPALハードディスク ドライブのSED認証を許可) 初期設定では無効になっています
System Management Command (システム管理コマンド)	サービス イベント中に、認定された担当者がセキュリティ設定をリセットできます。初期設定では有効になっています
Restore Security Settings to Default (セキュリティ設定を初期設定に復元)	このアクションを行うと、セキュリティ デバイスがリセットされ、BIOSパスワードがクリアされ (DriveLockを除く)、[Security]メニューの設定が工場出荷時の初期設定に戻ります

[HP Computer Setup] : [Advanced] (詳細設定)

以下の表では、[HP Computer Setup]の[Advanced]メニューについて説明します。


 **注** : [HP Computer Setup]でサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

表5-3 [HP Computer Setup] : [Advanced] (上級ユーザー向け)

項目	説明
Display Language (表示言語)	[HP Computer Setup]およびキーボード レイアウトのメニューの言語を選択できます
Scheduled Power-On (スケジュールされた電源投入)	この機能により、システムは指定された日時にオフになっている場合に復帰します
Boot Options (ブートオプション)	ワークステーションが起動できるデバイス、および以下を含むその他のオプションを選択します <ul style="list-style-type: none"> ● Startup Delay (sec) (スタートアップ遅延 (秒)) : この機能を有効にすると、ユーザーが指定した遅延時間がPOSTプロセスに追加されます。この遅延の目的の1つに、ホットキーが有効になる時間を追加で確保することがあります。たとえば、[Esc]キーによるスタートアップ メニューへのアクセスや、[F10]キーによる[HP Computer Setup]へのアクセスが有効になる時間を延ばせます ● Fast Boot (高速起動) : 初期設定では有効になっています ● USB Storage Boot (USBストレージブート) : 初期設定では有効になっています ● Network (PXE) Boot (ネットワーク (PXE) ブート) : 初期設定では有効になっています

表5-3 [HP Computer Setup] : [Advanced] (上級ユーザー向け) (続き)

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ● After Power Loss（電源喪失後の状態）：初期設定では[Power Off]（電源切断）になっています <ul style="list-style-type: none"> ■ Power off：ワークステーションに電力が供給されても、ワークステーションの電源は切れたままになります ■ Power on（電源投入）：ワークステーションに電力が供給されるとすぐにワークステーションの電源が自動的に入ります ■ Previous state（以前の状態への復帰）：ワークステーションが電源から切断されるときに電源がオンになっていた場合、電源に接続しなおすとすぐにワークステーションの電源がオンになります <p>注：システムが[Power On from Keyboard Ports]（キーボード コネクタから電源オン）に設定されている場合（[Power Management Options]（電源管理オプション）を参照してください）、この設定は強制的に[Power On]になります</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prompt on Memory Size Change（メモリ サイズの変更時に通知を表示する）：初期設定では有効になっています ● Prompt on Fixed Storage Change（固定ストレージの変更時に通知を表示する）：初期設定では無効になっています ● Audio Alerts During Boot（起動中の警告音）：初期設定では有効になっています。無効にすると、起動中に発生したエラー、警告、およびパスワード要求のビープ音のほとんどがオフになります ● UEFI Boot Order（UEFI ブート順序） <p>初期設定では有効になっています。UEFI ブートソース（内蔵ハードディスク ドライブ、USB ハードディスク ドライブ、USB オプティカル ドライブ、内蔵オプティカル ドライブなど）に起動可能なオペレーティング システムのイメージがあるかどうかをチェックする順序を指定します</p> <p>UEFI ブートソースは、レガシー ブートソースより常に優先されます</p> ● Legacy Boot Order（レガシー ブート順序） <p>レガシー ブート ソース（ネットワーク インターフェイス カード、内蔵ハードディスク ドライブ、USB オプティカル ドライブ、内蔵オプティカル ドライブなど）に起動可能なオペレーティング システムのイメージがあるかどうかをチェックする順序を指定します</p> <p>接続されたハードディスク ドライブのブート順序を指定します。最初のハードディスク ドライブはブート順序が優先され、C ドライブとして認識されます（他にデバイスが接続されている場合）</p> <p>注：デバイスを目的の位置まで移動するには、[Enter] キーを押します</p> <p>注：MS-DOS® のドライブ名の割り当ては、MS-DOS 以外のオペレーティング システムが起動された後は、適用されない場合があります</p> <p>Shortcut to Temporarily Override Boot Order（一時的に優先されるブート順序へのショートカット）</p> <p>[Boot Order]（ブート順序）で指定した初期設定のデバイス以外のデバイスから一度だけ起動するには、ワークステーションを再起動し、[Esc] キーを押して（スタートアップ メニューにアクセスして）から[F9]（ブート メニュー）を押すか、電源ボタン ランプが白色に点灯している間に[F9] キーを押します（スタートアップ メニューがスキップされます）。POST が完了すると、起動可能デバイスの一覧が表示されます。矢印キーを使用して目的の起動デバイスを選択し、[Enter] キーを押します。初期設定以外の選択したデバイスから、ワークステーションが一度だけ起動されます</p>
Secure Boot Configuration（セキュア ブートの構成）	<p>Configure Secure Boot（セキュア ブートの構成）</p> <p>セキュア ブート設定を構成します。初期設定では有効になっています</p> <p>Secure Boot Key Management（セキュア ブート キーの管理）</p> <p>カスタム キー設定を管理できます</p> <p>Import Custom Secure Boot keys（カスタムのセキュア ブート キーのインポート）</p> <p>初期設定では無効になっています</p> <p>Clear Secure Boot Keys（セキュア ブート キーのクリア）</p> <p>以前にロードされたカスタム ブート キーを削除できます。キーをクリアすると、セキュア ブートが無効になります。初期設定では無効になっています</p> <p>Reset Secure Boot keys to factory defaults（セキュア ブート キーの工場出荷時設定へのリセット）</p> <p>初期設定では無効になっています</p> <p>Enable MS UEFI CA key（MS UEFI CA キーの有効化）</p> <p>この設定を無効にすると、セキュア ブート キーの一覧が変更され、許可されるソフトウェア コンポーネントがさらに制限されます。デバイス ガードをサポートするには、このオプションを[disable]（無効化）に設定します</p> <p>Ready BIOS for Device Guard Use（デバイス ガードを使用するためのBIOSの準備）</p> <p>BIOS 管理者パスワードを構成し、セキュア ブートを有効にする必要があります</p>

表5-3 [HP Computer Setup]：[Advanced]（上級ユーザー向け）（続き）

項目	説明
----	----

System Options (システムオプション)	<p>Configure storage controller for RAID (RAID用にストレージコントローラーを構成) RAIDモードのサポートとしてストレージコントローラーを有効にします</p> <p>Hyperthreading (ハイパースレッディング) プロセッサの能力を制御できます。初期設定では有効になっています</p> <p>Multi-processor (マルチプロセッサ) このオプションを使用すると、オペレーティング システムの下でマルチプロセッサのサポートが無効になります。初期設定では有効になっています</p> <p>Virtualization Technology (仮想化技術) (VTx) (インテルのみ) プロセッサの仮想化機能を制御します。この設定を変更するには、ワークステーションの電源を切ってから再び電源を入れる必要があります。初期設定では無効になっています</p> <p>Virtualization Technology for Directed I/O (I/O仮想化技術) (VTd) (インテルのみ) チップセットの仮想化DMAリマップ機能を制御します。この設定を変更するには、ワークステーションの電源を切ってから再び電源を入れる必要があります。初期設定では無効になっています</p> <p>Accelerate USB Enumeration (USBエニューメレーションの高速化) 特定のUSBデバイスの検出時間を短縮します。初期設定では無効になっています</p> <p>Speed Selection on Mixed DIMM per Channel (チャネルごとの混合DIMMの速度選択) 混合DIMM構成のDRAM速度を決定できます。初期設定では有効になっています</p> <p>Turbo Boost (ターボ ブースト) インテル ターボ・ブースト・テクノロジーを有効にします。初期設定では有効になっています</p> <p>RST Remapping (RSTリマップ) M.2 SSDをインテルチップセットストレージコントローラーのドライブとして構成できます。初期設定では無効になっています</p> <p>NVMe Write Endurance Masking (NVMe書き込み耐久性マスキング) NVMeの書き込み耐久性を超えた場合に、システムはエラーを報告するために一時停止しません。初期設定では無効になっています</p> <p>Early PCIe Delay (PCIeの早期遅延) PCI Expressのトレーニングを完了させるためにPCIeアドオン カードの遅延を構成できます。初期設定では無効になっています</p> <p>DMA Protection (DMA保護) 選択すると、ダイレクトメモリ アクセス保護が有効になります。初期設定では有効になっています</p> <p>Pre-Boot DMA Protection (プリブートDMA保護) OS実行前のDMA保護のデバイス スコープを構成できます</p> <p>Performance Control (パフォーマンス制御) システムパフォーマンス モードを選択できます</p> <p>Power Button Override (電源ボタンのオーバーライド) (無効化/4秒/15秒) 無効にするか、または有効にして、システムが強制的に電源切断されるまで電源ボタンを押し続けるべき秒数を選択します。初期設定では4秒になっています</p>
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表5-3 [HP Computer Setup] : [Advanced] (上級ユーザー向け) (続き)

項目	説明
Built-In Device Options (内蔵デバイスオプション)	Embedded LAN Controller (内蔵LANコントローラー) 選択すると、オペレーティングシステムにデバイスが表示されます。初期設定では有効になっています
	Wake On LAN (ウェイク オンLAN) ウェイク オンLAN機能を無効にする、またはどこからワークステーションを起動するか(ネットワーク、ハードディスク ドライブなど)を構成することができます。初期設定では[Boot to Network] (ネットワークからのブート)になっています
	Video memory size (ビデオ メモリ サイズ) このオプションを使用して、グラフィックス メモリの割り当てを管理します。選択した値はグラフィックスカードに恒久的に割り当てられ、オペレーティングシステムでは利用できなくなります
	Integrated Camera (内蔵カメラ) クリアすると、内蔵カメラが無効になります。初期設定では有効になっています
	Audio Device (オーディオ デバイス) 選択すると、オペレーティングシステムにデバイスが表示されます。初期設定では有効になっています
	Integrated Microphone (内蔵マイク) クリアすると、内蔵マイクが無効になります。これは、オーディオ コネクタに接続されているデバイスには影響しません。初期設定では有効になっています
	Internal Speakers (内蔵スピーカー) (外付けスピーカーの設定には影響しません) クリアするとシャーシのスピーカーが無効になります。この機能は、オペレーティング システムの通常のオーディオ再生に適用され、POST時のエラーまたは警告のビープ音には影響しません。初期設定では有効になっています
	LAN/WLAN auto switching (LAN/無線LANの自動切り替え) 選択すると、有線接続と無線接続の自動切り替えが有効になります。初期設定では無効になっています
	Wake on WLAN (無線LAN経由のWOL) 選択すると、無線LAN経由でのWOL (ウェイク オンLAN) が有効になります。初期設定では無効になっています
	M.2 USB/Bluetooth 選択すると、M.2コントローラーが有効になります。初期設定では有効になっています
	Increase Idle Fan Speed (アイドル状態のファン速度の増加) (%) アイドル状態のファン速度 (%) を設定します。この機能では、ファンの最低速度のみ変更できます。ファン自体は自動的に制御されます
Port Options (ポートオプション)	SATA2 コネクタを無効にできます。初期設定では有効になっています
	Rear USB ports (リアUSBポート) これらのポートを無効にできます。初期設定では有効になっています
	Right USB ports (右側面のUSBポート) これらのポートを無効にできます。初期設定では有効になっています
	USB Legacy Port Charging (USBレガシー ポート充電) ワークステーションが休止またはシャットダウン モードになっているときに、USB充電機能を有効にできます。初期設定では有効になっています
	USB Type-C Downstream Charging (USB Type-Cダウンストリーム充電) ワークステーションが休止または電源オフ状態になっているときに、USB充電機能を有効にできます。初期設定では有効になっています
	Restrict USB Devices (USBデバイスの制限) 以下のUSBデバイスのカテゴリの有効化を指定します
	<ul style="list-style-type: none"> Allow all USB devices (すべてのUSBデバイスを許可) (初期設定) Allow only keyboard and mouse (キーボードおよびマウスのみを許可) Allow all but storage devices and hubs (ストレージ デバイスおよびハブ以外を許可)
	一部のデバイスが制限されている場合、システムは許可される条件を満たさないUSBポートを無効にします。USBデバイスは別のポートに移動できるため、通常、この機能はオペレーティング システム内の類似のポリシーと組み合わせられています。BIOSによって無効にされたポートは、システムを再起動するまで無効のままになります
	USB Type-C Controller Firmware Update (USB Type-Cコントローラーのファームウェア更新) 初期設定では有効になっています

表5-3 [HP Computer Setup] : [Advanced] (上級ユーザー向け) (続き)

項目	説明
Option ROM Launch Policy (オプションROMの起動ポリシー)	<p>これらのポリシーは、レガシー オプションROMまたはUEFIドライバーがロードされるかどうかを制御します。初期設定では[All UEFI] (すべてのUEFI) になっています</p> <p>Configure Option ROM Launch Policy (オプションROMの起動ポリシーの構成)</p> <ul style="list-style-type: none"> All legacy (すべてのレガシー) All UEFI (すべてのUEFI) All UEFI except video (ビデオを除くすべてのUEFI)
Power Management Options (電源管理オプション)	<p>Runtime Power Management (実行時の電源管理) (有効/無効)</p> <p>現時点でロードされているソフトウェアがプロセッサの最大能力を必要としない場合に、特定のオペレーティング システムでプロセッサの電圧および周波数を下げることができます。初期設定では有効になっています</p> <p>Extended Idle Power States (アイドル状態の拡張電力設定) (有効/無効)</p> <p>プロセッサがアイドル状態のときに、特定のオペレーティング システムがプロセッサの電力消費量を下げないようにします。初期設定では有効になっています</p> <p>S5 Maximum Power Savings (S5最大省電力) (有効/無効)</p> <p>この機能を有効に設定すると、システムの電力がS5状態で可能な限り節約されます。S5状態の間は、ウェイクアップ回路、拡張スロット、およびすべての管理機能に電源が供給されなくなります。初期設定では無効になっています</p> <p>SATA Power Management (SATAの電源管理) (有効/無効)</p> <p>SATAバスやデバイス電源管理の有効/無効を設定します。初期設定では有効になっています</p> <p>PCI Express Power Management (PCI Expressの電源管理) (有効/無効)</p> <p>このオプションを有効にすると、PCI ExpressリンクでASPM (Active Power State Management) を使用して、デバイスを使用していないときに省電力状態にすることができます。初期設定では有効になっています</p> <p>Power On from Keyboard Ports (キーボード コネクタから電源オン) (有効/無効)</p> <p>この機能が有効になっている場合、システムがオフ (S5状態) のときにキーを押すと、システムの電源がオンになります。USBキーボードを使用している場合は、キーボードアイコンのラベルが付いた背面のポートの1つにそれを接続する必要があります。初期設定では無効になっています</p> <p>Unique Sleep State Blink Rates (各スリープ状態時のランプの点滅速度) (有効/無効)</p> <p>システムがどのようなスリープ状態にあるかをユーザーに視覚的に示します。各スリープ状態には、固有の点滅パターンがあります。初期設定では無効になっています</p> <p>注: Windows 8以降では、通常のシャットダウンを実行するとS4状態になります</p> <p>S0 (オン) = ランプが白色に点灯します</p> <p>S3 (スタンバイ) = 1 Hz (50%のデューティ サイクル) で3回点滅した後、2秒間休止します (白色のランプ)。つまり、3回の点滅と休止状態のサイクルが繰り返されます</p> <p>S4 (休止状態) = 1 Hz (50%のデューティ サイクル) で4回点滅した後、2秒間休止します (白色のランプ)。つまり、4回の点滅と休止状態のサイクルが繰り返されます</p> <p>S5 (ソフト オフ) = ランプが消灯します</p>
Electronic labels (電子ラベル)	システム ラベルを表示します

表5-3 [HP Computer Setup] : [Advanced] (上級ユーザー向け) (続き)

項目	説明
Remote Management Options (リモート管理オプション)	<p>Active Management (AMT) (インテルのみ) (有効/無効) : 初期設定では有効になっていますネットワーク上のコンピューティング デバイスを検出、修復、および保護できます</p> <p>USB Key Provisioning Support (USBキー プロビジョニング サポート) (有効/無効) : 初期設定では無効になっています</p> <p>USB Redirection Support (USBリダイレクト サポート) (有効/無効) : 初期設定では有効になっています</p> <p>USBリダイレクトにより、クライアント ワークステーションに接続されているUSBデバイスをゲストオペレーティング システムに透過的にリダイレクトできます</p> <p>Unconfigure AMT on next boot (次回ブート時にAMTを構成解除) (Do Not Apply/Apply (適用しない/適用)) : 初期設定では[Do Not Apply]になっています</p> <p>SOL Terminal Emulation Mode (SOLターミナル エミュレーション モード) (ANSI/VT100) : 初期設定では[ANSI]になっています</p> <p>SOL (serial-over-LAN) 端末エミュレーション モードは、リモートAMT (Active Management Technology) リダイレクト操作中にのみアクティブ化されます。エミュレーション オプションを使用すると、管理者はコンソールに最も適したモードを選択できます</p> <p>Show Unconfigure ME Confirmation Prompt (MEの構成解除の確認メッセージを表示) (有効/無効) : 初期設定では有効になっています</p> <p>Verbose Boot Messages (詳細なブートメッセージ) (有効/無効) : 初期設定では有効になっています</p> <p>詳細な起動メッセージには、起動中のログ情報が追加で表示されます。主に、起動中に問題が発生した場合のデバッグに使用します</p> <p>Watchdog Timer (ウォッチドッグタイマー) (有効/無効) : 初期設定では有効になっています</p> <p>タイマーが無効になっていない場合にオペレーティング システムおよびBIOSのウォッチドッグ アラートが送信される時間を設定できます。BIOSウォッチドッグはBIOSによって無効にされ、アラートが管理コンソールに送信されると、実行が途中で停止したことを示します。オペレーティング システムのアラートはオペレーティング システム イメージによって無効にされ、初期化が途中で停止したことを示します</p> <ul style="list-style-type: none"> OS Watchdog Timer (min.) (OSウォッチドッグ タイマー (分)) - (5/10/15/20/25)。初期設定では5分になっています BIOS Watchdog Timer (min.) (BIOSウォッチドッグタイマー (分)) - (5/10/15/20/25)。初期設定では5分になっています <p>CIRA Timeout (min.) (CIRAタイムアウト (分)) (1/2/3/4/Never (なし))</p> <p>CIRAとは、Customer Initiated Remote Assistance (クライアント主導リモート アクセス) の略語であり、ユーザーによるアクティブ・マネジメント・テクノロジー (AMT) の利用を可能にするインテルのサービスです</p>

6 POSTエラー メッセージ


このセクションでは、POST（電源投入時のセルフテスト）実行中またはワークステーションの起動時に表示されるエラー コード、エラー メッセージ、およびさまざまなインジケータ ランプや音声コードについてまとめます。各エラーについて、考えられる原因や対処方法も示します。

POSTメッセージが無効になっていると、POST実行中のシステム メッセージ（メモリ カウント、エラーではないテキスト メッセージなど）が画面に表示されません。POSTエラーが発生した場合は、エラーメッセージが画面に表示されます。POST実行中に手動でPOSTメッセージを有効にするには、どれかのキー（[F10]、[F11]、または[F12]キーは除く）を押します。初期設定ではPOSTメッセージが無効に設定されています。

POSTモードの選択により、ワークステーションがオペレーティング システムをロードする速度と、ワークステーションがテストされる範囲が決まります。

クイック ブート（Quick Boot）を設定すると短時間で起動できますが、すべてのシステム レベルのテストを実行するわけではなく、メモリ テストなどは実行されません。フル ブート（Full Boot）を設定するとすべてのROMベースのシステム テストを実行しますので、完了するまでに時間がかかります。

フル ブートは、1～30日に1回、定期的に実行できます。このスケジュールを設定するには、[HP Computer Setup]で[Full Boot Every x Days]（x日毎にフル ブート）モードにワークステーションを再設定します。

 **注：** [HP Computer Setup]について詳しくは、[38ページの「コンピューター セットアップ \(F10\) ユーティリティ \(\[HP Computer Setup\]\)」](#)を参照してください。

POST時の数値コードおよびテキスト メッセージ

ここでは、数値コードが関連付けられているPOSTエラーについて説明します。また、POSTの実行中に表示されるテキスト メッセージについても説明します。


 **注：** POSTテキスト メッセージが表示されると、ビーブ音が1回鳴ります。

表7-1 POST時の数値コードおよびテキスト メッセージ

コントロール パネルのメッセージ	説明	推奨する対処方法
002-Option ROM Checksum Error (オプションROMチェックサム エラー)	システムROMまたは拡張ボードのオプションROMのチェックサム	<ol style="list-style-type: none">1. ROMが正しいかどうか確認します2. 必要に応じてROMをフラッシュします3. 最近拡張ボードを追加した場合は、その拡張ボードを取り外してみて問題が解決するかどうか確認します4. CMOSメモリをクリアします5. これでエラー メッセージが表示されなくなった場合は、拡張ボードの不具合と考えられます6. システム ボードを交換します（修理受付窓口へご連絡ください）
003-System Board Failure (システム ボード障害)	DMAまたはタイマーの障害	<ol style="list-style-type: none">1. CMOSメモリをクリアします2. システム ボードを交換します（修理受付窓口へご連絡ください）
005-Real-Time Clock Power Loss (リアルタイム クロック電源喪失)	コンフィギュレーション メモリの日付および時刻が無効。RTC（リアルタイム クロック）用電池が寿命に達している	Windowsのコントロール パネルにあるユーティリティを使用して日付と時刻を設定しなおします（[HP Computer Setup]を使用することもできます）。問題が解決しない場合は、RTC用電池を交換します。新しい電池の装着方法について詳しくは、「取り外しおよび取り付けの手順」の「電池」の項目を参照してください

表7-1 POST時の数値コードおよびテキスト メッセージ (続き)

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨する対処方法
008-Microcode Patch Error (マイクロコードパッチ エラー)	BIOSがプロセッサをサポートしていない	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOSを適切なバージョンにアップグレードします 2. プロセッサを交換します
009-PMM Allocation Error during MEBx Download (MEBxダウンロード中のPMM割り当てエラー)	Management Engine (ME) BIOS拡張オプションROMでのPOST実行中のメモリ エラー	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークステーションを再起動します 2. 電源コードを抜き取り、メモリ モジュールを取り付けなおしてから、ワークステーションを再起動します 3. 最近メモリの構成を変更した場合は、電源コードを抜き取り、メモリを元の構成に復元してから、ワークステーションを再起動します 4. 問題が解決しない場合は、システムボードを交換します
00A-Product Information Not Valid (製品情報が無効)	システム ボードにプログラムされている製品情報が無効であるか、情報が見つからない	この情報を更新するには、[HP Computer Setup]を使用します
00B-MEBx Module did not checksum correctly (MEBxモジュールのチェックサム検証失敗)	Management Engine (ME) BIOS拡張オプションROMでのPOST実行中のメモリ エラー	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークステーションを再起動します 2. 電源コードを抜き取り、メモリ モジュールを取り付けなおしてから、ワークステーションを再起動します 3. 最近メモリの構成を変更した場合は、電源コードを抜き取り、メモリを元の構成に復元してから、ワークステーションを再起動します 4. 問題が解決しない場合は、システムボードを交換します
00C-PMM Deallocation Error during MEBx Cleanup (MEBxクリーンアップ中のPMM割り当て解除エラー)	Management Engine (ME) BIOS拡張オプションROMでのPOST実行中のメモリ エラー	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークステーションを再起動します 2. 電源コードを抜き取り、メモリ モジュールを取り付けなおしてから、ワークステーションを再起動します 3. 最近メモリの構成を変更した場合は、電源コードを抜き取り、メモリを元の構成に復元してから、ワークステーションを再起動します 4. 問題が解決しない場合は、システムボードを交換します
00D-Setup Error during MEBx Execution (MEBx実行中の設定エラー)	MEBxを選択または終了すると、設定エラーが発生する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークステーションを再起動します 2. 電源コードを抜き取り、メモリ モジュールを取り付けなおしてから、ワークステーションを再起動します 3. 最近メモリの構成を変更した場合は、電源コードを抜き取り、メモリを元の構成に復元してから、ワークステーションを再起動します 4. 問題が解決しない場合は、システムボードを交換します

表7-1 POST時の数値コードおよびテキスト メッセージ（続き）

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨する対処方法
00E-Inventory Error during MEBx Execution (MEBx実行中のインベントリ エラー)	MEBxに送られたBIOS情報によってエラーが発生する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークステーションを再起動します 2. エラーが解決しない場合は、最新のBIOSバージョンに更新します 3. 問題が解決しない場合は、システムボードを交換します
00F-Interface Error during MEBx Execution (MEBx実行中のインターフェイス エラー)	MEとの通信中にMEBxを操作すると、ハードウェア エラーが発生する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークステーションを再起動します 2. エラーが解決しない場合は、最新のBIOSバージョンに更新します 3. 問題が解決しない場合は、システムボードを交換します
100-Front Audio Not Connected (前面オーディオ未接続)	前面オーディオ ケーブルとシステムボードとの接続が外れている	前面オーディオ ケーブルを取り付けなおします
2E1-MemorySize Error (メモリ サイズ エラー)	前回の起動以降、メモリ容量が変更された (メモリが追加されたか取り外された)	システム メモリのサイズが前回起動時と異なります。最もよくある理由は、システム ボードからメモリを取り外したことです。[F1]キーを押して変更を保存します
2E2-Memory Error (メモリ エラー)	起動中にメモリ モジュール構成が失敗した	<ol style="list-style-type: none"> 1. メモリ モジュールが正しく取り付けられていることを確認します 2. 正しいメモリ モジュールが装着されていることを確認します 3. 故障したメモリ モジュールを取り外して交換します 4. メモリ モジュールを交換しても問題が解決されない場合は、システムボードを交換します
2E3-Incompatible Memory Module in Memory Socket(s) X, X, ... (メモリ ソケットX、X、...の非互換メモリ モジュール)	エラー メッセージに示されたメモリ ソケットに装着されているメモリ モジュールに重要なSPD情報が設定されていない。またはメモリ モジュールがチップセットに対応していない	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正しいメモリ モジュールが装着されていることを確認します 2. 別のメモリ ソケットを使用してみます 3. サポートされるモジュールと交換します
2E4-DIMM Configuration Warning (DIMM構成の警告)	装着されたDIMM構成が最適化されていない	DIMMを取り付けなおして、各チャネルのメモリ容量が等しくなるようにします
2E5-ECC Memory Module Detected on Unsupported Platform (サポートされていないプラットフォームでECCメモリ モジュールが検出された)	ECCメモリをサポートしていないプラットフォーム上にECCメモリが装着されている	<ol style="list-style-type: none"> 1. メモリを追加している場合は取り外して見て、トラブルが解決するか確認します 2. ワークステーションの説明書を参照して、サポートされるメモリを確認します
2E6 – Memory Not Configured Correctly for Proper MEBx Execution (適切なMEBx実行のためにメモリが正しく構成されていない)	DIMM1が取り付けられていない	メモリ モジュールがDIMM1ソケットに正しく取り付けられていることを確認します
300 – Configuration Change Warning (構成変更の警告)	ストレージ構成の変更が検出された (この機能を有効にするには、BIOSセットアップの[Boot Options] (ブート オプション) メニューを参照してください)。取り付けたハードウェアが変更されたか、ストレージまたはファームウェア モードが変更されたか、ストレージ デバイスが応答しなかった可能性がある	この警告の前に変更が加えられていない場合は、ドライブが電源コードとシステム ボードに正しく接続されていることを確認します。ユーザー 診断 (起動時に[F2]キー) が特定のデバイスの問題を特定するときに役立つ場合があります

表7-1 POST時の数値コードおよびテキスト メッセージ (続き)

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨する対処方法
301-Hard Disk 1: SMART Hard Drive Detects Imminent Failure (ハードディスク1: SMARTハードディスク ドライブが緊急の障害を検出)	ハードディスク ドライブの障害 (一部のハードディスク ドライブには、間違ったエラー メッセージを修正する、ハードディスク ドライブ ファームウェアのパッチがあります)	<ol style="list-style-type: none"> 1. エラー メッセージが正しいか確認します。ワークステーションの起動中に[F2診断]を使用して[ドライブ保護システム]テストを実行します 2. 必要であれば、ハードディスク ドライブ ファームウェアのパッチを利用します (https://support.hp.com/jp-ja/で入手できます) 3. ハードディスク ドライブのデータのバックアップを作成した後、ハードディスク ドライブを交換します
302-Hard Disk 2: SMART Hard Drive Detects Imminent Failure (ハードディスク2: SMARTハードディスク ドライブが緊急の障害を検出)	ハードディスク ドライブの障害 (一部のハードディスク ドライブには、間違ったエラー メッセージを修正する、ハードディスク ドライブ ファームウェアのパッチがあります)	<ol style="list-style-type: none"> 1. エラー メッセージが正しいか確認します。ワークステーションの起動中に[F2診断]を使用して[ドライブ保護システム]テストを実行します 2. 必要であれば、ハードディスク ドライブ ファームウェアのパッチを利用します (https://support.hp.com/jp-ja/で入手できます) 3. ハードディスク ドライブのデータのバックアップを作成した後、ハードディスク ドライブを交換します
309 - 30C: Hard Disk 3 - 6: SMART Hard Drive Detects Imminent Failure (ハードディスク3 ~ 6: SMARTハードディスク ドライブが緊急の障害を検出)	ハードディスク ドライブの障害 (一部のハードディスク ドライブには、間違ったエラー メッセージを修正する、ハードディスク ドライブ ファームウェアのパッチがあります)	<ol style="list-style-type: none"> 1. エラー メッセージが正しいか確認します。ワークステーションの起動中に[F2診断]を使用して[ドライブ保護システム]テストを実行します 2. 必要であれば、ハードディスク ドライブ ファームウェアのパッチを利用します (https://support.hp.com/jp-ja/で入手できます) 3. ハードディスク ドライブのデータのバックアップを作成した後、ハードディスク ドライブを交換します
3F0 - Boot Device Not Found (ブート デバイスが見つからない)	ブート デバイスが見つからない	ブート デバイスを挿入するか、オペレーティングシステムをロードします
3F1 - Hard Disk 1 Error (ハードディスク ドライブ1のエラー)	ハードディスク ドライブ1のエラー	<ol style="list-style-type: none"> 1. ケーブルの接続を確認し、必要であれば交換します 2. CMOSメモリをクリアします 3. ハードディスク ドライブを交換します
3F2 - Hard Disk 2 Error (ハードディスク ドライブ2のエラー)	ハードディスク ドライブ2のエラー	<ol style="list-style-type: none"> 1. ケーブルの接続を確認し、必要であれば交換します 2. CMOSメモリをクリアします 3. ハードディスク ドライブを交換します
400-Serial Port A Address Conflict Detected (シリアル ポートAのアドレス競合を検出)	外部および内部シリアル コネクタが同じリソースに割り当てられている	<ol style="list-style-type: none"> 1. シリアル コネクタの拡張カードをすべて取り外します 2. CMOSメモリをクリアします 3. カード リソースを再設定するか、[HP Computer Setup]またはWindowsのユーティリティを実行します

表7-1 POST時の数値コードおよびテキスト メッセージ（続き）


コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨する対処方法
401-Serial Port B Address Conflict Detected (シリアル ポートBのアドレス競合を検出)	外部および内部シリアル コネクタが同じリソースに割り当てられている	<ol style="list-style-type: none"> 1. シリアル コネクタの拡張カードをすべて取り外します 2. CMOSメモリをクリアします 3. カード リソースを再設定するか、[HP Computer Setup]またはWindowsのユーティリティを実行します
402-Serial Port C Address Conflict Detected (シリアル ポートCのアドレス競合を検出)	外部および内部シリアル コネクタが同じリソースに割り当てられている	<ol style="list-style-type: none"> 1. シリアル コネクタの拡張カードをすべて取り外します 2. CMOSメモリをクリアします 3. カード リソースを再設定するか、[HP Computer Setup]またはWindowsのユーティリティを実行します
403-Serial Port D Address Conflict Detected (シリアル ポートDのアドレス競合を検出)	外部および内部シリアル コネクタが同じリソースに割り当てられている	<ol style="list-style-type: none"> 1. シリアル コネクタの拡張カードをすべて取り外します 2. CMOSメモリをクリアします 3. カード リソースを再設定するか、[HP Computer Setup]またはWindowsのユーティリティを実行します
419-Out of Memory Space for Option ROMs (オプションROMのメモリ領域不足)	取り付けたPCI拡張カードに含まれるオプションROMが、POST実行時にダウンロードするには大きすぎる	PCI拡張カードを取り付けている場合は取り外して見て、トラブルが解決するか確認します
41A-Front USB1/USB2 Not Connected (前面USB1/USB2未接続)	前面USBケーブルとシステム ボードとの接続が外れている	前面USBケーブルを取り付けなおします
41B-Device in PCI Express Slot Failed To Initialize (PCI Expressスロットのデバイスが初期化に失敗した)	PCIeデバイスに非互換性または問題があり、システムまたはPCIeリンクを有効なバス幅または速度に構成できなかった	システムを再起動してみます。それでもエラーが発生する場合は、お使いのシステムでは機能しないデバイスである可能性があります
43A-USB Type-C I2C Not Connected (USB Type-C I2C未接続)	カード上のI2Cとシステム ボード上のUSB-C間にケーブルが必要である	カード上のI2Cとシステム ボード上のUSB-C間にケーブルを取り付けます
43B-More Than One USB type-C Cards Are Installed (複数のUSB Type-Cカードが装着されている)	複数のUSB Type-Cカードが装着されている	USB Type-Cカードを取り外して、1つだけ取り付けられている状態にします
500 - BIOS Recovery (BIOSリカバリ)	システムBIOSのリカバリが発生した	該当なし
70x-Wireless Mode Not Supported (無線モード未サポート)	システムに搭載されている無線モジュールがサポートされておらず、無効になっていることがシステムによって検出された	サポートされるモジュールと交換します
800-KeyBoard Error (キーボード エラー)	キーボードの障害	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークステーションの電源を切り、キーボードを接続しなおします 2. コネクタが曲がっていないか、またはピンがなくなっていないかを確認します 3. 押されたままになっているキーがないか確認します 4. 必要であれば、キーボードを交換します
801-KeyBoard or System Unit Error (キーボードまたはシステム ユニットのエラー)	キーボードの障害	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークステーションの電源を切り、キーボードを接続しなおします

表7-1 POST時の数値コードおよびテキスト メッセージ（続き）

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨する対処方法
		<ol style="list-style-type: none"> 2. 押されたままになっているキーがないか確認します 3. キーボードを交換します 4. システム ボードを交換します（修理受付窓口へご連絡ください）
900-CPU Fan Not Detected（CPUファン未検出）	CPUファンが接続されていないか、障害がある	<ol style="list-style-type: none"> 1. ファンを取り付けなおします 2. ファン ケーブルを接続しなおします 3. ファンを交換します
901-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected（シャーシ、リア シャーシ、またはフロント シャーシ ファン未検出）	ファンが接続されていないか、障害がある	<ol style="list-style-type: none"> 1. ファンを取り付けなおします 2. ファン ケーブルを接続しなおします 3. ファンを交換します
904-SATA Cabling Error（SATAケーブルのエラー）	1つまたは複数のSATAデバイスが正しく接続されていない。最適なパフォーマンスを得るには、ハードディスク ドライブに対してSATA 0およびSATA 1コネクタを他のコネクタの前に使用する必要がある	SATAコネクタが昇順で使用されていることを確認します。デバイスが1つの場合、SATA 0を使用します。デバイスが2つの場合、SATA 0およびSATA 1を使用します。デバイスが3つの場合、SATA 0、SATA 1、およびSATA 2を使用します
90B-Fan Failure（ファンの障害）	冷却ファンが正しく動作していないことがシステムによって検出された	<ol style="list-style-type: none"> 1. ファンを取り付けなおします 2. ファン ケーブルを接続しなおします 3. ファンを交換します
90D-System Temperature（システム温度）	サーマル シャットダウンが発生した。前回、過熱を防ぐためにワークステーションがシャットダウンされたことがシステムBIOSによって検出された。過熱は、冷却用通気孔がふさがれていたり、動作温度がシステム仕様を超えたりした場合に発生することがある。過熱状態が解消されるとワークステーションは正常な動作に戻る	システムに適切な通気が確保されていることを確認します
90E-Power Supply Fan Not detected（電源装置ファン未検出）	電源装置ファンが接続されていないか、障害がある	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源装置ファンを取り付けなおします 2. ファン ケーブルを接続しなおします 3. 電源装置ファンを交換します
910-Filter Warning（フィルター警告）	エアフロー フィルターが汚れている	エアフロー フィルターを交換します

システム検証用のフロント パネルのランプおよびビープ音の診断

ここでは、フロント パネルのランプ コードおよびビープ音について説明します。これらは、POSTの前またはPOST実行中に発生し、エラー コードまたはテキスト メッセージが関連付けられていない可能性があります。

 **注意：**ワークステーションが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていてもシステムボードには常に電気が流れています。感電ややけどの危険がありますので、ワークステーションのメンテナンス等を行うときは、事前に、電源コードが電源コンセントから抜き取ってあることおよび本体内部の温度が下がっていることを必ず確認してください。

システムの起動時に発生するシステム検証フェーズ中に、BIOSは以下のサブシステムおよび状態の機能を検証します。

- ACアダプター
- システム ボードの電源
- プロセッサの障害
- BIOSの破損
- メモリの障害
- グラフィックスの障害
- システム ボードの障害
- BIOSの認証の失敗

エラーが検出された場合、長い点滅および短い点滅と、それと同時に発生する長いビープ音および短いビープ音（該当する場合）から成る特定のパターンを参考にしてエラーを識別できます。これらのパターンは、以下の2つの部分から成るコードを形成します。

- メジャー：エラーのカテゴリ
- マイナー：カテゴリ内の特定のエラー

 **注：**1回のビープ音/点滅のコードは使用されません。

表7-2 ビープ音のパターンによるエラーの識別

長いビープ音/点滅の回数	エラー カテゴリ
1	なし
2	BIOS
3	ハードウェア
4	温度
5	システム ボード

点滅/ビープ音のコードのパターンは、以下のパラメーターを用いて決定されます。

- 最後のメジャーの点滅後、1秒休止する。
- 最後のマイナーの点滅後、2秒休止する。
- パターンが最初に5回繰り返す間、ビープ音のエラー コード シーケンスが鳴り、その後停止する。
- ワークステーションを電源から取り外すか、電源ボタンを押すまで、点滅のエラー コード シーケンスが続く。

 **注：**一部のランプやビープ音の診断を使用できないモデルもあります。

ランプが赤く点滅する場合、メジャーのエラー カテゴリ（長い点滅）を示します。ランプが白く点滅する場合、マイナーのエラー カテゴリ（短い点滅）を示します。たとえば、「3.5」は、3回の赤く長い点滅および5回の白く短い点滅により、プロセッサが検出されないことを伝えます。

表7-3 POST診断時のフロントパネルのランプおよびビープ音のコードの解釈

カテゴリ	メジャー/マイナー コード	説明
BIOS	2.2	BIOSのメイン領域（DXE）が破損し、利用できるリカバリ バイナリ イメージがない
	2.3	内蔵コントローラーのポリシーにより、ユーザーがキー シーケンスを入力する必要がある
	2.4	内蔵コントローラーがブート ブロックのチェックまたはリカバリを実行している

表7-3 POST診断時のフロント パネルのランプおよびビープ音のコードの解釈（続き）

カテゴリ	メジャー/マイナー コード	説明
ハードウェア	3.2	内蔵コントローラーが、BIOSのメモリ初期化からの復帰を待つタイムアウトした
	3.3	内蔵コントローラーが、BIOSのグラフィックス初期化からの復帰を待つタイムアウトした
	3.4	システム ボードが電源の障害（クローバー）を示している*
	3.5	プロセッサが検出されない*
	3.6	プロセッサが、有効に設定されている機能をサポートしていない
温度	4.2	プロセッサの過熱状態が検出された*
	4.3	周囲温度の過熱状態が検出された
	4.4	MXM過熱状態が検出された
システム ボード	5.2	内蔵コントローラーが有効なファームウェアを検出できない
	5.3	内蔵コントローラーが、BIOSを待つタイムアウトした
	5.4	内蔵コントローラーが、BIOSのシステム ボード初期化からの復帰を待つタイムアウトした
	5.5	内蔵コントローラーが、システム ヘルス タイマー、自動システム復旧タイマー、またはその他の機構を使用してロック状態が検出された後で、システムを再起動した


* ハードウェアによって開始されたイベントを示します。他のすべてのイベントはBIOSによって制御されます。

7 パスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定

パスワードの設定は[HP Computer Setup]メニューから行えます。[HP Computer Setup]メニューで設定できるセキュリティ用のパスワードには、[Administrator Password]（管理者パスワード）および[Power-On Password]（電源投入時パスワード）の2つがあります。

管理者パスワードだけを設定した場合、[HP Computer Setup]で設定した情報以外のすべての情報に、他のユーザーがアクセスできます。電源投入時パスワードだけを設定した場合、[HP Computer Setup]による設定情報のほか、ワークステーション上のすべての情報にアクセスするときに、電源投入時パスワードの入力が必要となります。管理者パスワードと電源投入時パスワードの両方を設定した場合、管理者パスワードの入力によってのみ[HP Computer Setup]にアクセスできます。

両方のパスワードが設定されている場合、ワークステーションへログインするときに電源投入時パスワードの代わりに管理者パスワードを使用できます。これはネットワーク管理者には便利な機能です。

 **重要：**後で必要になったときに再設定するために、BIOS設定をバックアップするか、カスタムの初期設定として保存します。バックアップは、[HP Computer Setup]で、または<http://www.hp.com/jp/> から入手可能なBiosConfigUtilityツールを使用して実行できます。BIOS設定のバックアップについては、[38ページの「コンピューター セットアップ \(F10\) ユーティリティ \(\[HP Computer Setup\]\)」](#)を参照してください。


セットアップパスワードまたは電源投入時パスワードの変更

以下の手順を使用して、パスワードを変更します。

電源投入時パスワードまたはセットアップパスワードを変更するには、以下の操作を行います。

1. ワークステーションの電源を入れるか再起動します。
セットアップパスワードを変更する場合は、手順2に進みます。
Power-On Password（電源投入時パスワード）を変更する場合は、手順3に進みます。
2. セットアップ パスワードを変更する場合は、ワークステーションの起動後すぐ、以下の操作を行います。
 - [Press the ESC key for Startup Menu]（[Esc]キーを押して[起動メニュー]を表示します）というメッセージが表示されている間に[Esc]キーを押します。
 - [F10]キーを押して[HP Computer Setup]を起動します。
3. 鍵形のアイコンが表示されたら、次のように入力します。

現在のパスワード/新しいパスワード/新しいパスワード

 **注：**文字は画面に表示されないため、新しいパスワードは間違えないよう注意して入力してください。

4. [Enter]キーを押します。

新しいパスワードは、次回ワークステーションを再起動したときに有効になります。

セットアップパスワードまたは電源投入時パスワードの削除

以下の手順を使用して、パスワードを削除します。

電源投入時パスワードまたはセットアップパスワードを削除するには、以下の操作を行います。

1. ワークステーションの電源を入れるか再起動します。
セットアップパスワードを削除する場合は、手順2に進みます。
電源投入時パスワードを削除する場合は、手順3に進みます。
2. セットアップパスワードを削除する場合は、ワークステーションの起動後すぐ、以下の操作を行います。
 - [Press the ESC key for Startup Menu] ([Esc]キーを押して[起動メニュー]を表示します) というメッセージが表示されている間に[Esc]キーを押します。
 - [F10]キーを押して[HP Computer Setup]を起動します。
3. 鍵形のアイコンが表示されたら、次のように入力します。
現在のパスワード/
4. [Enter]キーを押します。

8 [HP PC Hardware Diagnostics]の使用

[HP PC Hardware Diagnostics]ユーティリティを使用して、ワークステーションのハードウェアが正しく実行されているかどうかを確認できます。Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]、UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 版の[HP PC Hardware Diagnostics]、および（一部の製品のみ）ファームウェア機能の[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]の3つのバージョンがあります。

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]の使用（一部の製品のみ）

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]は、診断テストを実行して、ワークステーションのハードウェアが正常に動作しているかどうかを確認できるWindowsベースのユーティリティです。このツールは、ハードウェア障害を診断するためにWindowsオペレーティングシステム内で実行されます。

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]がお使いのワークステーションにインストールされていない場合は、まず、ダウンロードしてインストールする必要があります。Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]をダウンロードする場合は、[61ページの「Windows版の\[HP PC Hardware Diagnostics\]のダウンロード」](#)を参照してください。

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のハードウェア障害IDコードの使用

ハードウェアの交換が必要な障害がWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]で検出された場合、24桁の障害IDコードが生成されます。

- ▲ 画面の指示に応じて、以下のオプションのどちらかを選択します。
 - 障害IDリンクが表示されている場合は、リンクを選択して、画面の説明に沿って操作します。
 - サポートに電話するための説明が表示された場合は、その指示に従ってください。

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールした後は、[スタート]メニューまたは[HP Support Assistant]からアクセスできます。

[スタート]メニューからのWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールした後[スタート]メニューからアクセスするには、以下の手順で操作します。

1. [スタート]ボタンを選択します。
2. [HP PC Hardware Diagnostics for Windows]を右クリックして、[More]（その他）→[管理者として実行]の順に選択します。
3. ツールが開いたら、実行する診断テストの種類を選択し、画面に表示される説明に沿って操作します。



注：診断テストを停止するには、[キャンセル]を選択します。

[HP Support Assistant]からのWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス


Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールした後[HP Support Assistant]からアクセスするには以下の手順で操作します。

1. タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリを選択します。

または

タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。

2. [Troubleshooting and fixes] (トラブルシューティングと修復) を選択します。
3. [Diagnostics] (診断) → [HP PC Hardware Diagnostics Windows]の順に選択します。
4. ツールが開いたら、実行する診断テストの種類を選択し、画面に表示される説明に沿って操作します。

 **注：** 診断テストを停止するには、[キャンセル]を選択します。

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロードの説明は、英語でのみ提供されています。.exeファイルのみが提供されているため、このツールのダウンロードにはWindowsワークステーションを使用する必要があります。

HPからの最新バージョンのWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード

HPからWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]をダウンロードするには、以下の操作を行います。

1. <https://www8.hp.com/jp/ja/campaigns/hpsupportassistant/pc-diags.html> にアクセスします。[HP PC Hardware Diagnostics]のホーム ページが表示されます。
2. [Download HP Diagnostics Windows]を選択してから、ワークステーションまたはUSBフラッシュ ドライブ上の場所を選択します。

ツールは選択した場所にダウンロードされます。

[Microsoft Store]からのWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード


[Microsoft Store]からWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]をダウンロードできます。

1. デスクトップで[Microsoft Store]アプリを選択するか、タスクバーの検索ボックスに「Microsoft Store」と入力します。
2. [Microsoft Store]の検索ボックスに「HP PC Hardware Diagnostics Windows」と入力します。
3. 画面の説明に沿って操作します。

ツールは選択した場所にダウンロードされます。

製品名または製品番号を使用したWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード (一部の製品のみ)

製品名または製品番号を使用してWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]をダウンロードできます。

 **注：** 一部の製品では、製品名または製品番号を使用してこのソフトウェアをUSBフラッシュ ドライブにダウンロードすることが必要な場合があります。

1. HPのサポートWebサイト、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスします。
2. [ソフトウェアドライバ]を選択し、製品の種類を選択して、製品を自動的に検出させるか、検索ボックスにシリアル番号または製品名か製品番号を入力します。
3. [診断]セクションで、[Download] (ダウンロード) を選択して画面の説明に沿って操作し、ワークステーションまたはUSBフラッシュ ドライブにダウンロードするWindows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のバージョンを選択します。


ツールは選択した場所にダウンロードされます。

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]のインストール

Windows版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールするには、お使いのワークステーションまたはUSBフラッシュドライブ上の.exeファイルをダウンロードしたフォルダーに移動し、.exeファイルをダブルクリックして、画面の説明に沿って操作します。

UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]の使用

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 版の[HP PC Hardware Diagnostics]は、診断テストを実行して、ワークステーションのハードウェアが正常に動作しているかどうかを確認できるUEFIベースのユーティリティです。このツールはオペレーティング システムの外で実行されるため、オペレーティング システムまたはその他のソフトウェア コンポーネントが原因で発生する可能性のある問題からハードウェア障害を分離できます。

 **注：** Windows 10 Sワークステーションの場合、.exeファイルのみが提供されるため、WindowsワークステーションとUSBフラッシュドライブを使用してHP UEFIサポート環境をダウンロードおよび作成する必要があります。詳しくは、[63ページの「UEFI版の\[HP PC Hardware Diagnostics\]のUSBフラッシュドライブへのダウンロード」](#)を参照してください。

お使いのワークステーションでWindowsが起動しない場合は、UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]を使用してハードウェアの問題を診断できます。

UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のハードウェア障害IDコードの使用


ハードウェアの交換が必要な障害がUEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]で検出された場合、24桁の障害IDコードが生成されます。


問題を解決するために支援が必要な場合は、以下のようにしてください。

▲ **[HPへのお問い合わせ]**を選択し、HPプライバシー免責事項に同意してから、モバイル デバイスを使用して次の画面に表示される障害IDコードをスキャンします。HPカスタマー サポートのサービス センター ページが表示され、障害IDおよび製品番号が自動的に入力されます。画面の説明に沿って操作します。

または

サポートに連絡し、障害IDコードを提供してください。

 **注：** モードの変更が可能なワークステーションで診断を開始するには、お使いのワークステーションをノートブック モードにして、ワークステーションに取り付けられているキーボードを使用する必要があります。

 **注：** 診断テストを停止する必要がある場合は、[\[Esc\]](#)キーを押します。


UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]の起動

UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]を起動するには、以下の操作を行います。

1. ワークステーションの電源を入れるかワークステーションを再起動してすぐに[\[Esc\]](#)キーを押します。
2. [\[F2\]](#)キーを押します。

BIOSは、以下の順序で3か所の診断ツールを検索します。

- a. 接続されているUSBフラッシュドライブ


 **注：** [HP PC Hardware Diagnostics] (UEFI) ツールをUSBフラッシュドライブにダウンロードするには、[63ページの「最新バージョンのUEFI版の\[HP PC Hardware Diagnostics\]のダウンロード」](#)を参照してください。

- b. ハードディスク ドライブ
- c. BIOS
3. 診断ツールが開いたら、言語および実行する診断テストの種類を選択し、画面に表示される説明に沿って操作します。

UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のUSBフラッシュドライブへのダウンロード

次のような場合には、UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]をUSBフラッシュドライブにダウンロードすると便利です。

- UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]がプリインストールイメージに含まれていない。
- UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]がHP TOOLSパーティションに含まれていない。
- ハードディスクドライブが故障している。

 **注：**UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロードの説明は、英語でのみ提供されています。また、.exeファイルのみが提供されているため、Windowsワークステーションを使用して、[HP UEFI Support Environment]（HP UEFIサポート環境）をダウンロードおよび構築する必要があります。


最新バージョンのUEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード

最新バージョンのUEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]をUSBフラッシュドライブにダウンロードするには、以下の操作を行います。

1. <https://www8.hp.com/jp/ia/campaigns/hpsupportassistant/pc-diags.html> にアクセスします。[HP PC Hardware Diagnostics]のホーム ページが表示されます。
2. [HP Diagnostics UEFIをダウンロードする]を選択してから、[保存]を選択します。

製品名または製品番号を使用したUEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード（一部の製品のみ）

製品名または製品番号を使用して、UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]をUSBフラッシュドライブにダウンロードできます（一部の製品のみ）。

 **注：**一部の製品では、製品名または製品番号を使用してこのソフトウェアをUSBフラッシュドライブにダウンロードすることが必要な場合があります。

1. HPのサポートWebサイト、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスします。
2. 製品名または製品番号を入力し、お使いのワークステーションを選択して、オペレーティング システムを選択します。
3. [診断]セクションで、画面の説明に沿って、お使いのワークステーションに合ったUEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]のバージョンを選択してダウンロードします。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定の使用（一部の製品のみ）

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]は、UEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]をワークステーションにダウンロードするファームウェア（BIOS）の機能です。この機能では、ワークステーションの診断を実行し、事前に設定されたサーバーに結果をアップロードできます。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]について詳しく確認するには、HPのWebサイト、<https://www8.hp.com/jp/ia/campaigns/hpsupportassistant/pc-diags.html> にアクセスして、[もっと詳しく知る]を選択します。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]は、サーバーにダウンロード可能なSoftPaqとしても提供されています。


最新バージョンの[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード

最新バージョンのUEFI版の[HP PC Hardware Diagnostics]をUSBフラッシュドライブにダウンロードできます。

1. <https://www8.hp.com/jp/ia/campaigns/hpsupportassistant/pc-diags.html> にアクセスします。[HP PC Hardware Diagnostics]のホームページが表示されます。
2. [Remote Diagnosticsをダウンロードする]を選択してから、[保存]を選択します。

製品名または製品番号による[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード

製品名または製品番号を使用して[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]をダウンロードできます。

 **注：**一部の製品では、製品名または製品番号を使用してこのソフトウェアをダウンロードすることが必要な場合があります。

1. HPのサポートWebサイト、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスします。
2. [ソフトウェアドライバー]を選択し、製品の種類を選択して、製品を自動的に検出させるか、検索ボックスにシリアル番号または製品名か製品番号を入力します。
3. [診断]セクションで、画面の説明に沿って、製品に合った[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のバージョンを選択してダウンロードします。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定のカスタマイズ

[HP Computer Setup] (BIOS) の[Remote HP PC Hardware Diagnostics]設定を使用して、以下のカスタマイズを実行できます。

- 自動診断の実行スケジュールを設定する。[Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics] (Remote HP PC Hardware Diagnosticsの実行) を選択して、対話モードで診断をすぐに開始することもできます。
- 診断ツールをダウンロードする場所を設定する。この機能により、HPのWebサイトから、または事前に設定されたサーバーを使用して、ツールにアクセスできます。リモート診断を実行するために、従来のローカルストレージ (ハードディスクドライブやUSBフラッシュドライブなど) がワークステーションに装備されている必要はありません。
- テスト結果を保存する場所を設定する。アップロードに使用するユーザー名およびパスワードを設定することもできます。
- 以前に実行された診断の状態に関する情報を表示する。


[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定をカスタマイズするには、以下の操作を行います。

1. ワークステーションの電源を入れるか再起動し、HPのロゴが表示されたら[F10]キーを押して[HP Computer Setup]を起動します。
2. [Advanced] (カスタム) → [Settings] (設定) の順に選択します。
3. カスタマイズの内容に応じて選択します。
4. [Main] (メイン) を選択し、[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) を選択して設定内容を保存します。

変更した内容は、次回ワークステーションを起動したときに有効になります。

9 バックアップ、復元、および回復

WindowsツールまたはHPのソフトウェアを使用して、情報のバックアップ、復元ポイントの作成、ワークステーションのリセット、リカバリ メディアの作成、またはワークステーションの工場出荷時状態への復元を行うことができます。これらの標準的な手順を実行すると、ワークステーションをすばやく動作状態に戻すことができます。

 **重要：** タブレットで復元手順を実行する場合は、復元プロセスを開始する前に、タブレットのバッテリーを少なくとも70%充電する必要があります。

重要： 取り外し可能なキーボードを備えたタブレットの場合は、復元プロセスを開始する前に、タブレットをキーボードベースに接続します。


情報のバックアップおよびリカバリ メディアの作成

リカバリ メディアおよびバックアップを作成するための以下の方法は、一部の製品でのみ使用可能です。

Windowsツールを使用したバックアップ

初期設定の直後に情報をバックアップすることをおすすめします。このタスクは、外付けUSBドライブでローカルにWindowsバックアップを使用するか、オンライン ツールを使用して実行できます。

 **重要：** Windowsは、個人情報をバックアップできる唯一のオプションです。情報の損失を避けるために、定期的なバックアップをスケジュールします。


 **注：** ワークステーションのストレージが32 GB以下の場合、Microsoftの[システムの復元]は、初期設定で無効に設定されている場合があります。


[HP Cloud Recovery Download Tool]を使用したリカバリ メディアの作成（一部の製品のみ）

[HP Cloud Recovery Download Tool]を使用して、ブート可能なUSBフラッシュ ドライブ上に[HP Recovery]メディアを作成できます。

詳しくは、以下を参照してください。

▲ HPのサポートWebサイト、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスし、「HP Cloud Recovery」を検索して、お使いのワークステーションの種類に一致する結果を選択します。

 **注：** 自分でリカバリ メディアを作成できない場合は、サポートに連絡してリカバリ ディスクを入手してください。<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスして、画面の説明に沿って操作します。

 **重要：** HPリカバリ ディスクを入手して使用する前に、[66ページの「復元およびリカバリの方法」](#)に従ってワークステーションを復元することをおすすめします。最近のバックアップを使用すると、HPリカバリ ディスクを使用するよりも早くマシンを動作状態に戻すことができます。システムが復元された後、最初の購入以降にリリースされたすべてのオペレーティング システム ソフトウェアを再インストールすると、長いプロセスになる可能性があります。

システムの復元およびリカバリ

デスクトップを読み込めない場合に、Windowsの内外でシステムを回復するために利用できるツールがいくつかあります。

[67ページの「復元およびリカバリの方法」](#)を使用してシステムの復元を試みることをおすすめします。

システムの復元の作成


[システムの復元]はWindowsで利用できます。[システムの復元]ソフトウェアは、特定の時点でのワークステーション上のシステム ファイルおよび設定の復元ポイント（スナップショット）を自動または手動で作成できます。

[システムの復元]を使用すると、復元ポイントを作成したときの状態にワークステーションが戻ります。個人用ファイルおよびドキュメントは影響を受けません。

復元およびリカバリの方法

最初の方法を実行した後、次の方法に進む前に、問題がまだ存在するかどうかをテストしてください。次の方法に進む必要がなくなっている場合があります。


1. Microsoftの[システムの復元]を実行します。
2. このワークステーションのリセットを実行します。

 **注：** [すべて削除する] オプションおよび [ドライブを完全にクリーンアップする] オプションを順に実行すると、完了するまでに数時間かかる場合がありますが、ワークステーションには情報が残りません。ワークステーションをリサイクルする前にリセットするのが最も安全な方法です。

3. [HP Recovery] メディアを使用して復元します。詳しくは、[66ページの「\[HP Recovery\]メディアを使用した復元」](#)を参照してください。

最初の2つの方法の詳細については、[問い合わせ] アプリを参照してください。


▲ [スタート] ボタンを選択し、[問い合わせ] アプリを選択してから、実行するタスクを入力します。

 **注：** [問い合わせ] アプリにアクセスするには、インターネットに接続している必要があります。

[HP Recovery]メディアを使用した復元


[HP Recovery] メディアを使用すると、工場出荷時にインストールされた元のオペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムを復元できます。一部の製品では、[HP Cloud Recovery Download Tool] を使用してブート可能なUSBフラッシュ ドライブで作成できます。

詳しくは、[65ページの「\[HP Cloud Recovery Download Tool\]を使用したリカバリ メディアの作成（一部の製品のみ）」](#)を参照してください。

 **注：** 自分でリカバリ メディアを作成できない場合は、サポートに連絡してリカバリ ディスクを入手してください。<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスして、画面の説明に沿って操作します。


システムを復元するには、以下の操作を行います。

▲ [HP Recovery] メディアを挿入し、ワークステーションを再起動します。

 **注：** HPリカバリ ディスクを入手して使用する前に、[66ページの「復元およびリカバリの方法」](#)に従ってワークステーションを復元することをおすすめします。最近のバックアップを使用すると、HPリカバリ ディスクを使用するよりも早くマシンを動作状態に戻すことができます。システムが復元された後、最初の購入以降にリリースされたすべてのオペレーティング システム ソフトウェアを再インストールすると、長いプロセスになる可能性があります。

ワークステーションのブート順序の変更

[HP Recovery] メディアを使用してもお使いのワークステーションが再起動しない場合は、ワークステーションのブート順序を変更できます。これは起動情報を参照するためのBIOSにあり、デバイスの順番が一覧になっています。[HP Recovery] メディアの場所に応じて、オプティカル ドライブまたはUSBフラッシュ ドライブを選択できます。

 **重要：** 取り外し可能なキーボードを備えたタブレットの場合は、これらの手順を開始する前に、タブレットをキーボードベースに接続します。

ブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

1. [HP Recovery] (HPリカバリ) メディアを挿入します。
2. システムの[スタートアップ]メニューにアクセスします。
 - キーボードが接続されているワークステーションまたはタブレットの場合は、ワークステーションまたはタブレットの電源を入れるか再起動してすぐに[Esc]キーを押し、次に[F9]キーを押してブート オプションを表示します。
 - キーボードのないタブレットの場合は、タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量上げボタンを押したまま、[F9]キーを選択します。または
タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量下げボタンを押したまま、[F9]キーを選択します。
3. 起動するオプティカル ドライブまたはUSBフラッシュ ドライブを選択してから、画面の説明に沿って操作します。

[HP Sure Recover]の使用（一部の製品のみ）

一部のワークステーション モデルは、ハードウェアおよびソフトウェアに組み込まれたPC OS修復ソリューションである[HP Sure Recover]を使用して構成されています。[HP Sure Recover]は、リカバリ ソフトウェアをインストールしなくても、HP OSイメージを完全に復元できます。

[HP Sure Recover]を使用すると、管理者またはユーザーはシステムを復元して以下のものをインストールできます。

- オペレーティング システムの最新バージョン
- プラットフォーム固有のデバイス ドライバー
- カスタム イメージの場合、ソフトウェア アプリケーション

[HP Sure Recover]の最新のドキュメントを参照するには、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスしてください。画面の説明に沿って製品を検索し、ドキュメントを見つけます。


10 メモリ揮発性について

HPワークステーションの不揮発性メモリに関する一般的な情報、およびシステムの電源を切り、ハードディスク ドライブを取り外した後、個人データを含む可能性のある不揮発性メモリを復元する方法については、以下の操作を行います。

インテル®ベースまたはAMD®ベースのシステム ボードを使用するHPワークステーション製品には、揮発性DDRメモリが搭載されています。システムに存在する不揮発性メモリの容量はシステム構成によって異なります。以下を前提とすると、インテルベースおよびAMDベースのシステム ボードには、HPからの初期出荷の時点で不揮発性メモリ サブコンポーネントが搭載されています。

- システムにその後の変更が加えられていない。
- システムにアプリケーション、機能、または機能性が追加またはインストールされていない。

システムをシャットダウンしてHPワークステーション システムのすべての電源を切った後、揮発性システム メモリ (DIMM) に個人データが一定期間残っている可能性があり、不揮発性メモリにも個人データが残ります。インテルベースおよびAMDベースのシステム ボード上の不揮発性メモリを含め、ワークステーションから個人データを削除するには、以下の操作を行います。


 **注：** タブレットにキーボード ベースがある場合は、この章の手順を開始する前にキーボード ベースに接続してください。

現在のBIOSステップ


不揮発性メモリを復元するには、以下の操作を行います。

1. 個人データが含まれる可能性がある不揮発性メモリを復元するには、以下の手順を実行します。個人データが格納されない不揮発性メモリを復元または再プログラムする必要はなく、推奨もしていません。


- a. ワークステーションの電源を入れるかワークステーションを再起動してすぐに[Esc]キーを押します。

 **注：** システムにBIOS管理者パスワードがある場合は、プロンプトでパスワードを入力します。

- b. [Main] (メイン) → [Apply Factory Defaults and Exit] (工場出荷時設定を適用して終了) → [Yes] (はい) の順に選択して初期設定をロードします。ワークステーションが再起動します。
- c. 再起動時、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に[Esc]キーを押します。


 **注：** システムにBIOS管理者パスワードがある場合は、プロンプトでパスワードを入力します。

- d. [Security] (セキュリティ) メニューを選択し、[Restore Security Settings to Factory Defaults] (セキュリティ設定を工場出荷時設定に復元する) → [Yes]の順に選択して、セキュリティ レベルの初期設定を復元します。ワークステーションが再起動します。
- e. 再起動時、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に[Esc]キーを押します。

 **注：** システムにBIOS管理者パスワードがある場合は、プロンプトでパスワードを入力します。

- f. アセット タグまたはオーナーシップ タグが設定されている場合、[Security]メニューを選択し、[Utilities]メニューまでスクロールします。[System IDs] (システムID) → [Asset Tracking Number] (アセット タグ) の順に選択します。タグを消去し、選択を行って前のメニューに戻ります。

- g. DriveLockパスワードが設定されている場合、[Security]メニューを選択し、[Utilities]メニューの下にある[Hard Drive Utilities]（ハードドライブ ユーティリティ）までスクロールします。
[Hard Drive Utilities]→[DriveLock]の順に選択し、[DriveLock password on restart]（再起動時のDriveLockパスワード）チェックボックスをオフにします。[OK]を選択して次に進みます。
- h. [Main]メニューを選択し、[Reset BIOS Security to factory default]（BIOSセキュリティを工場出荷時の設定に戻す）を選択します。警告メッセージが表示されたら[Yes]を選択します。ワークステーションが再起動します。
- i. 再起動時、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に[Esc]キーを押します。


 **注：**システムにBIOS管理者パスワードがある場合は、プロンプトでパスワードを入力します。

- j. [Main]メニューを選択し、[Apply Factory Defaults and Exit]→[Yes]の順に選択して、変更内容を保存して終了した後、[Shutdown]（シャットダウン）を選択します。
 - k. システムを再起動します。システムにTPM（Trusted Platform Module）か指紋認証システム（またはその両方）が搭載されている場合は、1つまたは2つのプロンプトが表示されます。TPMをクリアするためのプロンプトと、指紋認証センサーをリセットするためのプロンプトです。受け入れる場合は[F1]キーを、拒否する場合は[F2]キーを押すかタップします。
 - l. すべての電源およびシステム電池を24時間以上取り外します。
2. 以下のどれかの操作を完了します。

- ストレージドライブを取り外して保管します。
または
- SSDからデータを消去するために設計された他社製ユーティリティを使用して、ドライブの内容を消去します。
または
- 以下に示すBIOSセットアップの[Secure Erase]（完全消去）コマンド オプションの手順を使用して、ドライブの内容を消去します。

[Secure Erase]を使用して消去したデータは復元できません。

- a. ワークステーションの電源を入れるかワークステーションを再起動してすぐに[Esc]キーを押します。
- b. [Security]メニューを選択し、[Esc]メニューまでスクロールします。
- c. [Hard Drive Utilities]を選択します。
- d. [Utilities]の下にある[Secure Erase]を選択し、消去するデータが格納されているハードディスクドライブを選択し、画面上の指示に従って操作を続行します。
または
次の[Disk Sanitizer]（ディスクのデータ消去）コマンドの手順を使用して、ドライブの内容をクリアします。
 - i. ワークステーションの電源を入れるかワークステーションを再起動してすぐに[Esc]キーを押します。
 - ii. [Security]メニューを選択し、[Utilities]メニューまでスクロールします。
 - iii. [Hard Drive Utilities]を選択します。
 - iv. [Utilities]の下にある[Disk Sanitizer]を選択し、消去するデータが格納されているハードディスクドライブを選択し、画面上の指示に従って操作を続行します。

 **注：**[Disk Sanitizer]の実行には、数時間かかる場合があります。開始する前に、ワークステーションを電源コンセントに接続してください。

不揮発性メモリの使用状況

不揮発性メモリの使用状況のトラブルシューティングを行うには、以下の表を使用します。

表11-1 不揮発性メモリの使用状況のトラブルシューティング手順


不揮発性メモリの種類	容量 (サイズ)	顧客データの格納の有無	電源切断時のデータ保持の有無	このメモリの目的	このメモリへのデータ入力方法	このメモリの書き込み保護方法
HP Sure Start フラッシュ (一部のモデルのみ)	8 MB	無	有	HP Sure Start をサポートする一部のプラットフォームで、重要なシステム BIOS コード、EC ファームウェア、および重要なワークステーション構成データの保護されたバックアップを提供します 詳しくは、 73 ページの「HP Sure Start の使用 (一部の製品のみ)」 を参照してください	ホスト プロセッサを介してこのデバイスにデータを書き込むことはできません。内容は HP Sure Start 内蔵コントローラーによってのみ管理されます	このメモリは HP Sure Start 内蔵コントローラーによって保護されます
リアルタイムクロック (RTC) 電池バックアップ CMOS コンフィギュレーションメモリ	256 バイト	無	有	システム日時や重要でないデータを格納します	RTC 電池バックアップ CMOS は、[HP Computer Setup] を使用してプログラムされるか、Windows の日付と時刻を変更しています	このメモリは書き込み保護されません
コントローラー (NIC) EEPROM	64 KB (お客様はアクセス不可)	無	有	NIC 構成および NIC ファームウェアを格納します	NIC EEPROM は、DOS から実行できる NIC ベンダー提供ユーティリティを使用してプログラムされます	このメモリにデータを書き込むには、NIC ベンダーから入手できるユーティリティを使用する必要があります。この ROM に不適切な方法でデータを書き込むと、NIC が動作しなくなります
DIMM シリアル プレゼンス検出 (SPD) 構成データ	メモリ モジュールあたり 256 バイト、128 バイトがプログラム可能 (お客様はアクセス不可)	無	有	メモリ モジュール情報を格納します	DIMM SPD はメモリ ベンダーによってプログラムされます	モジュールがワークステーションに取り付けられているときは、このメモリにデータを書き込むことはできません。具体的な書き込み保護方法はメモリ ベンダーによって異なります
システム BIOS	9 MB	有	有	システム BIOS コードおよびワークステーション構成データを格納します	システム BIOS コードは出荷時にプログラムされます。システム BIOS が更新されると、コードが更新されます。構成データおよび設定は、[HP Computer Setup] (BIOS) またはカスタムユーティリティを使用して入力されます	注： この ROM に不適切な方法でデータを書き込むと、ワークステーションが動作しなくなる可能性があります このメモリにデータを書き込むには、HP の Web サイトから入手できるユーティリティを使用する必要があります。 https://support.hp.com/jp-ja/ にアクセスして製品を特定し、画面の説明に沿って操作します

表11-1 不揮発性メモリの使用状況のトラブルシューティング手順（続き）

不揮発性メモリの種類	容量（サイズ）	顧客データの格納の有無	電源切断時のデータ保持の有無	このメモリの目的	このメモリへのデータ入力方法	このメモリの書き込み保護方法
インテル®マネジメント・エンジンのファームウェア（一部のEliteまたはZモデルにのみ存在します。詳しくは、 https://support.hp.com/jp-ia/ にアクセスしてください。[マニュアルおよび特定の製品情報については、製品を識別してください。]を選択してから、画面の説明に沿って操作します）	1.5 MBまたは7 MB	有	有	マネジメント・エンジンのコード、設定、プロビジョニングデータ、および他社製iAMTデータストアを格納します	マネジメント・エンジンのコードは出荷時にプログラムされます。コードはインテルのセキュアファームウェア更新ユーティリティによって更新されます。一意なプロビジョニングデータは出荷時に、または管理者がマネジメント・エンジン（MEBx）セットアップユーティリティを使用して入力できます。他社製データストアの内容は、その領域にアクセスできるように管理者が登録したりリモート管理コンソールまたはローカルアプリケーションによって入力できます	インテルのチップセットは、ハードウェア保護を強制し、この領域の直接読み取り/書き込みアクセスをすべてブロックするように構成されています。ファームウェアの更新にはインテルのユーティリティを使用する必要があります。このユーティリティを使用して適用できるのは、インテルによってデジタル署名されたファームウェア更新だけです
Bluetoothフラッシュ（一部の製品のみ）	2メガビット	無	有	Bluetooth構成およびファームウェアを格納します	Bluetoothフラッシュは出荷時にプログラムされます。このメモリにデータを書き込むためのツールは公開されていませんが、シリコンベンダーから入手できます	このメモリにデータを書き込むにはユーティリティを使用する必要があります。フラッシュのアップグレードが必要な場合はいつでも、新しいバージョンのドライバーから利用できます
802.11無線LAN EEPROM	4キロビットから8キロビット	無	有	構成およびキャリブレーションデータを格納します	802.11無線LAN EEPROMは出荷時にプログラムされます。このメモリにデータを書き込むためのツールは公開されていません	このメモリにデータを書き込むにはユーティリティを使用する必要があります。固有の問題に対処するためにファームウェアのアップグレードが必要でない限り、通常は一般に公開されません
カメラ（一部の製品のみ）	64キロビット	無	有	カメラ構成およびファームウェアを格納します	カメラのメモリは、Windowsから実行できるデバイス製造元のユーティリティを使用してプログラムされます	このメモリにデータを書き込むにはユーティリティを使用する必要があります。固有の問題に対処するためにファームウェアのアップグレードが必要でない限り、通常は一般に公開されません
指紋認証システム（一部の製品のみ）	512 KBフラッシュ	有	有	指紋テンプレートを格納します	指紋認証システムのメモリは、[HP ProtectTools Security Manager]でのユーザー登録によってプログラムされます	デジタル署名されたアプリケーションのみが、フラッシュへの書き込みを呼び出すことができます

このセクションでは、不揮発性メモリに関する質問に答えます。

1. どうすればBIOS設定を復元できますか（工場出荷時設定に戻せますか）

 **重要**：初期設定の復元機能を使用しても、ハードディスク ドライブ上のデータは一切、完全消去されません。データを完全消去する手順については、6番のQ&Aを参照してください。

初期設定の復元機能を使用しても、カスタムのセキュア ブート キーはリセットされません。キーのリセットについては、7番のQ&Aを参照してください。

- a. ワークステーションの電源を入れるかワークステーションを再起動してすぐに[Esc]キーを押します。
- b. [Main]（メイン）→[Apply Factory Defaults and Exit]（工場出荷時設定を適用して終了）の順に選択します。
- c. 画面の説明に沿って操作します。
- d. [Main]→[Save Changes and Exit]（変更を保存して終了）の順に選択し、画面の説明に沿って操作します。

2. UEFI BIOSとは何ですか。従来のBIOSとの違いは何ですか

UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）BIOSは、プラットフォーム ファームウェアとオペレーティング システム（OS）の間にある、業界標準のソフトウェア インターフェイスです。古いBIOSアーキテクチャの後継ですが、従来のBIOS機能の多くをサポートします。

UEFI BIOSは従来のBIOSと同様、システム情報や構成設定を表示したり、OSがロードされる前にワークステーションの構成を変更したりするためのインターフェイスを提供します。BIOSは、グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）をサポートする安全な実行時環境を提供します。この環境では、ポインティング デバイス（タッチスクリーン、タッチパッド、ポイント スティック、またはUSBマウス）やキーボードを使用して、メニューを移動したり構成を選択したりできます。UEFI BIOSには基本的なシステム診断機能も含まれています。

UEFI BIOSは従来のBIOSよりも高度な機能を提供します。またUEFI BIOSは、OSをロードして実行する前にワークステーションのハードウェアを初期化する働きをします。実行時環境により、ストレージ デバイスからソフトウェア プログラムをロードして実行することが可能になり、（より詳細なシステム情報を表示する）高度なハードウェア診断、高度なファームウェア管理、リカバリソフトウェアなどの、より高度な機能が提供されます。

HPでは、オペレーティング システムで必要な場合に従来のBIOSでの動作を可能とするオプションを[HP Computer Setup]で提供しています。この要件の例としては、OSをアップグレードまたはダウングレードする場合があります。

3. UEFI BIOSはどこにありますか

UEFI BIOSはフラッシュ メモリ チップに搭載されています。チップに書き込むには、ユーティリティを使用する必要があります。


4. DIMMシリアル プレゼンス検出（SPD）メモリ モジュールにはどのような種類の構成データが格納されますか。このデータはどのようにして書き込まれますか

DIMM SPDメモリには、サイズ、シリアル番号、データ幅、速度とタイミング、電圧、温度情報など、メモリ モジュールに関する情報が記憶されます。この情報はモジュールの製造元によって書き込まれ、EEPROMに格納されます。メモリ モジュールがワークステーションに取り付けられている場合、このEEPROMに書き込むことはできません。メモリ モジュールがワークステーションに取り付けられていないときにEEPROMに書き込むことができる他社製ツールが存在します。さまざまな他社製ツールを使用してSPDメモリを読み取ることができます。

5. [Restore the nonvolatile memory found in Intel-based system boards] (インテルベースのシステムボードに搭載された不揮発性メモリを復元する) とはどのような意味ですか

このメッセージは、ワークステーションの構成データを含むリアルタイム クロック (RTC) CMOS メモリの消去に関連するものです。

6. BIOSセキュリティを工場出荷時の初期設定にリセットしてデータを消去するにはどうすればよいですか

 **重要**：リセットすると情報が失われます。

以下の手順では、カスタムのセキュア ブート キーはリセットされません。キーのリセットについて詳しくは、7番のQ&Aを参照してください。

- ワークステーションの電源を入れるかワークステーションを再起動してすぐに[Esc]キーを押します。
 - [Main] (メイン) → [Reset Security to Factory Defaults] (セキュリティを工場出荷時の設定に戻す) の順に選択します。
 - 画面の説明に沿って操作します。
 - [Main] → [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、画面の説明に沿って操作します。
7. カスタムのセキュア ブート キーをリセットするにはどうすればよいですか

セキュア ブートは、認証されたコードだけがプラットフォーム上で開始できることを保証するための機能です。セキュア ブートを有効にしてカスタムのセキュア ブート キーを作成した場合、セキュア ブートを無効にしてもキーはクリアされません。カスタムのセキュア ブート キーのクリアも選択する必要があります。カスタムのセキュア ブート キーの作成に使用したのと同じ、セキュア ブート アクセス手順を使用しますが、すべてのセキュア ブート キーをクリアまたは削除するように選択します。

- ワークステーションの電源を入れるかワークステーションを再起動してすぐに[Esc]キーを押します。
- [Security] (セキュリティ) メニューを選択し、[Secure Boot Configuration] (セキュア ブートの設定) を選択して、画面の説明に沿って操作します。
- [Secure Boot Configuration] ウィンドウで、[Secure Boot] (セキュア ブート) → [Clear Secure Boot Keys] (セキュア ブート キーのクリア) の順に選択し、画面の説明に沿って操作を続けます。

[HP Sure Start]の使用 (一部の製品のみ)

一部のワークステーション モデルは、HP Sure Startが構成されています。HP Sure Startは、攻撃または破損からワークステーションのBIOSを継続的に監視する技術です。

BIOSが破損したか攻撃された場合、HP Sure Startはユーザーが介入することなくBIOSを以前の安全な状態に復元します。一部のワークステーション モデルは、出荷時にHP Sure Startが構成され、有効になっています。HP Sure Startはあらかじめ構成され有効になっているため、ほとんどのユーザーはHP Sure Startの初期設定の構成を使用できます。詳しい知識があるユーザーは、初期設定の構成をカスタマイズできます。

[HP Sure Start]の最新のドキュメントを参照するには、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスしてください。

11 電源コードセットの要件

一部のワークステーションの電源装置には、外部電源スイッチがあります。


ワークステーションの電圧選択スイッチ機能により、100 V AC～120 V ACまたは220 V AC～240 V ACの任意の線間電圧で動作できます。外部電源スイッチを備えていないワークステーションの電源装置には、入力電圧を検知して自動的に適切な電圧に切り替える内部スイッチが装備されています。

ワークステーションに付属の電源コード セットは、機器を購入した国や地域で使用するための要件を満たしています。

他の国で使用する電源コード セットは、ワークステーションを使用する国や地域の要件を満たしている必要があります。


一般的な要件

- 以下の要件はすべての国/地域に適用されます。
1. 電源コードは、電源コード セットを設置する国/地域での評価を担当する認証機関の承認を受ける必要があります。
 2. 電源コード セットの最小電流容量は10 A（日本のみ7 A）であり、各国の電力システムの要件に応じて、公称電圧定格は125 V ACまたは250 V ACである必要があります。
 3. ワイヤの直径は0.75 mm²または18 AWG以上である必要があり、コードの長さは1.8 m（6フィート）から3.6 m（12フィート）の間である必要があります。
- 電源コードは、その上または横に置かれた物品によって圧迫されたり、挟まれたりしないように配線する必要があります。プラグ、電源コンセント、および製品からコードが出ている位置に特に注意を払う必要があります。

 **警告！** 破損した電源コード セットで本製品を操作しないでください。電源コード セットが何らかの形で損傷している場合は、すぐに交換してください。

日本の電源コードの要件

日本で使用する場合は、この製品に付属の電源コードのみを使用してください。

 **重要：** この製品に付属の電源コードを他の製品に使用しないでください。

各国および各地域固有の要件

ここでは、国/地域に固有の追加要件について説明します。

表12-1 各国および各地域固有の電源コードの要件

国または地域	認定機関	国または地域	認定機関
オーストラリア（1）	EANSW	イタリア（1）	IMQ
オーストリア（1）	OVE	日本（3）	METI
ベルギー（1）	CEBC	ノルウェー（1）	NEMKO

表12-1 各国および各地域固有の電源コードの要件（続き）

国または地域	認定機関	国または地域	認定機関
カナダ（2）	CSA	スウェーデン（1）	SEMKO
デンマーク（1）	DEMKO	スイス（1）	SEV BSI UL
フィンランド（1）	SETI	英国（1）	
フランス（1）	UTE	米国（2）	
ドイツ（1）	VDE		

1. フレキシブルコードは、タイプHO5VV-F、3導体、0.75 mm²導体サイズである必要があります。電源コードセットの付属品（電源接続器およびプラグ）には、使用する国/地域の評価担当機関の認証マークが付いている必要があります。
2. フレキシブルコードは、タイプSVTまたは同等のもの、No. 18 AWG、3導体である必要があります。プラグは、NEMA 5-15P（15 A、125 V）またはNEMA 6-15P（15 A、250 V）構成の2極アース（接地）タイプである必要があります。
3. 電源接続器、フレキシブルコード、およびプラグには、日本の電取法に従ってTマークおよび登録番号を付ける必要があります。フレキシブルコードは、タイプVCTまたはVCTF、3導体、0.75 mm²導体サイズである必要があります。プラグは、日本工業規格C8303（7 A、125 V）構成の2極アースタイプである必要があります。

12 仕様

このセクションでは、お使いのワークステーションの仕様について説明します。

表12-1 仕様

国際単位系	
寸法	
高さ	58 mm
幅	216 mm
奥行き	216 mm
質量（概算）	
パフォーマンス	2.1 kg
エントリー	1.9 kg
温度範囲	
動作時	5 ~ 35°C
非動作時	- 40 ~ 60°C
注： 動作温度は、継続的に直射日光の当たらない環境で、海拔3,000 mまで300 mごとに1.0°C下がります。最大変化率は10°C/時です。取り付けられたオプションの種類および数によって、上限が異なります	
動作保証高度（非加圧）	
動作時	3,048 m
非動作時	9,144 m
相対湿度（結露せず）	
動作時	10 ~ 90%
非動作時（38.7°C 最高、湿球）	5 ~ 95%
電源装置	
動作電圧範囲	90 ~ 264 V AC
定格電圧範囲 ¹	100 ~ 240 V AC
定格入力電源周波数	50 ~ 60 Hz
動作入力電源周波数	47 ~ 63 Hz
標準効率	280 W、89%効率
	180 W、89%効率

¹ このシステムでは、アクティブな電圧自動補正機能を備えた電源装置を使用しています。このため、欧州連合諸国で使用するためのCEマークの要件を満たしています。アクティブな電圧自動補正機能を備えた電源装置には、入力電圧範囲選択スイッチを必要としないという利点もあります。

索引

A

[Advanced] (詳細設定) メニュー、
HP Computer Setup 44

C

CMOS
クリアと再設定 58

H

HP Computer Setup
[Advanced] (詳細設定) メ
ニュー 44
[Main] (メイン) メニュー 39
[Security] (セキュリティ) メ
ニュー 41
HP Computer Setup 38
[HP Computer Setup]の使用 38
[HP PC Hardware Diagnostics UEFI]
起動 62
使用 62
ダウンロード 63
[HP Recovery]メディア
リカバリ 66
HP Sure Recover 67
HP Sure Start 68, 73

M

[Main]メニュー、HP Computer Setup
39

P

POSTエラー メッセージ 50

R

[Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI]設定
カスタマイズ 64
使用 63

S

SATA
システム ボード上のコネクタ 9,
15
データ ケーブルのピン配列 9,
15
ハードディスク ドライブの特性
9, 15
[Security] (セキュリティ) メ
ニュー、HP Computer Setup 41

T

T-15トルクス ドライバー 9, 14, 14

JAWW

W

Windows
システムの復元ポイント 65
バックアップ 65
リカバリ メディア 65
Windowsツール、使用 65
Windows版の[HP PC Hardware
Diagnostics]
アクセス 60
インストール 62
使用 60
ダウンロード 61

あ

アース (接地) の方法 9, 10
アクセス パネル
図 4
安全上の注意事項
清掃 9, 12

え

エラー
コード 50, 55
エラー メッセージ 50
エラーの数字コード 50

お

温度コントロール 9, 12
温度センサー
取り外しと取り付け 27

か

各部
前面 1
背面 2, 3
過熱、防止 9, 12

き

キーボード
清掃 9, 12, 13
起動オプション
フル ブート 50
クイック ブート 50
揮発性システム メモリからの個人
データの削除 68

く

国および地域の電源コード セット
の要件 74

グラフィックス カード
取り外し 24

け

ケーブルの管理 9, 15
ケーブルのピン配列、SATAデータ
9, 15

こ

工具、保守 9, 14, 14
コンピューターの清掃 9, 12

し

システム ボード
図 4
取り外しと取り付け 32
SATAコネクタ 9, 15
システム メモリ、揮発性メモリか
らの個人データの削除 68
システムの復元 66
システムの復元ポイント、作成 65
仕様
ワークステーション 76
メモリ 19
仕様、製品 3
上面カバー
取り外しと取り付け 18

す

図による部品カタログ 4
スピーカー
図 4
取り外しと取り付け 25

せ

清掃
安全上の注意事項 9, 12
コンピューター 9, 12
マウス 9, 12, 13
静電気 9
静電気放電 (ESD) 9
損傷の防止 9, 10
セットアップパスワード 58
セットアップパスワードの削除
59
セットアップパスワードの変更
58

そ

各国および各地域固有の要件 77

操作のガイドライン 9, 12
その他の部品 8
ソフトウェア
 コンピューターの保守 9, 14, 14
ソリッドステートドライブ
 取り外しと取り付け 22
ソリッドステートドライブ 7

た
大容量ストレージデバイス 7

つ
通気、適切 9, 12

て
底面カバー
 取り外しと取り付け 34
電源コードセットの要件
 各国固有 74
電源装置
 図 4
 動作電圧範囲 76
電源投入時パスワード 58
電源投入時パスワードの削除 59
電源投入時パスワードの変更 58
電源ボタン ボード
 取り外しと取り付け 31
電池
 廃棄 9, 14, 15
電池の交換 34

と
取り付け
 電池 34
 メモリ 19
取り外し
 グラフィックスカード 24
 電池 34
 ハードディスク ドライブ 23
取り外しと取り付け
 温度センサー 27
 システム ボード 32
 上面カバー 18
 スピーカー 25
 ソリッドステート ドライブ 22
 底面カバー 34
 電源ボタン ボード 31
 背面のポート拡張ボード 27
 ファン 26
 プロセッサ 30
 プロセッサ ヒート シンク 28
 無線LANモジュール 35
 無線アンテナ 37

メモリ 19

な
内部部品の位置と名称 18

ね
ネジ、正しいサイズ 9, 14, 14

は
ハードディスク ドライブ
 SATAの特性 9, 15
 適切な取り扱い 9, 14, 14
 取り外し 23
ハードディスク ドライブ 7
背面のポート拡張ボード
 取り外しと取り付け 27
パスワード
 セキュリティ 58
 セットアップ 58
 電源投入時 58
バックアップ 65
バックアップ、作成 65

ひ
ビープ音 55

ふ
ファン
 図 4
 取り外しと取り付け 26
ファン付きヒート シンク
 図 4
ブート順序、変更 66
不揮発性メモリ 68
復元 65
プロセッサ
 図 4
 取り外しと取り付け 30
プロセッサ ヒート シンク
 取り外しと取り付け 28
フロント パネル
 図 4

ほ
保守上の留意事項 9, 14

ま
マウス
 清掃 9, 12, 13

む
無線LANモジュール
 取り外しと取り付け 35
無線アンテナ

取り外しと取り付け 37

め
メモリ
 仕様 19
 揮発性 68
 ソケットへの装着 19
 取り外しと取り付け 19
 不揮発性 68
メモリ モジュール
 図 4
 取り付け 19

ら
ランプ
 PS/2キーボードでの点滅 55
ランプの点滅 55

り
リカバリ 65
 USBフラッシュ ドライブ 66
 ディスク 66
 メディア 66
リカバリ メディア 65
 [HP Cloud Recovery Download
 Tool]を使用した作成 65
 Windowsツールを使用した作成
 65

わ
ワークステーションの機能 1